

IICIE国际集成电路创新博览会  
极具规模及影响力的集成电路及半导体综合展

# 展前预览

与CIOE中国光博会、elexcon深圳国际电子展暨嵌入式展同期同地举办

三展规模：5000+参展商 | 320,000平方米 | 240,000+专业观众 | 120+同期会议

同期展会：



即刻扫码登记获取参观证件



[P3 IICIE国际集成电路创新博览会](#)

[P3 展馆主题分布图](#)

[P4 参展代表企业](#)

[P5 主题展示区](#)

[P6 会议一览](#)



[P8 晶圆制造及封装测试服务](#)

[P9 半导体设备——制造设备](#)

[P11 半导体设备——封装设备](#)

[P13 检测及测试测量设备&仪器](#)

[P15 半导体材料](#)

[P19 计算与通信](#)

[P21 车规级芯片](#)

[P22 消费电子 / 工控类芯片及器件](#)

[P24 EDA&IP](#)

[P25 半导体核心零部件](#)

[P31 洁净&环境处理](#)

[P33 科研院所&高校](#)



[P35 同期三展联动，一证通览](#)

· [AI算力基础设施](#) · [半导体制造与智能制造](#)

· [消费电子、AR&VR](#) · [汽车及具身机器人](#)

[P44 组团参观 & 一对一采购对接](#)

[P45 交通指引](#)

[P46 线上服务](#)

领取参观证件

\*本资料由主办方根据展商提交内容整理，当前版本信息截至至7月29日，内容将持续更新中!



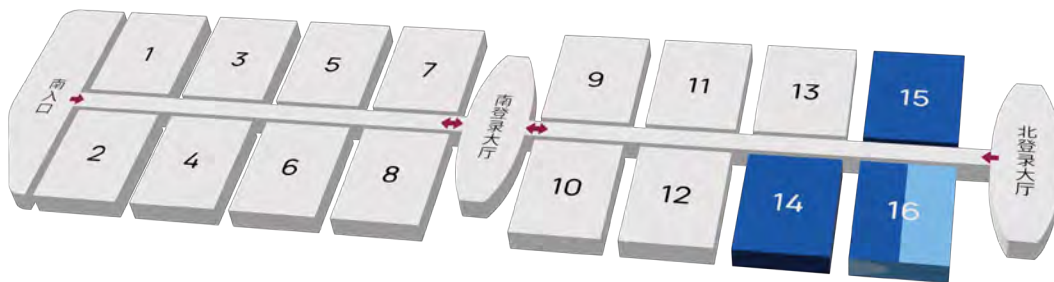
IICIE国际集成电路创新博览会(IC创新博览会)将于9月9-11日在深圳国际会展中心举办，展会以“跨界融合·全链协同，共筑特色芯生态”为主题，致力打造具备规模化效应、以应用为导向、以产品为核心的集成电路全产业链协同创新与交流合作高端展示平台。

展会呈现芯片及芯片设计、晶圆制造、封装测试、核心设备、关键材料及核心零部件的全链条生态布局。在这里，您既能与IDM、Fabless、Fab、OSAT 等半导体核心领域企业深度对接，也能直面人工智能、消费电子、汽车、通信及计算、显示、光电、新能源等领域的广泛观众。

同期将于**第27届中国国际光电博览会（CIOE中国光博会）**、以及**elexcon第23届深圳国际电子展暨嵌入式展**将在深圳国际会展中心（宝安）同期举行。本届三展联动，规模达到32万平方米，预计汇聚超5000家参展企业、吸引逾24万名专业观众，共同打造集技术展示、行业交流与商业合作为一体的国际化高端平台，为光电、集成电路、电子与嵌入式系统等关键领域注入强劲创新动力；

**三展规模：320,000平方米 | 5000+参展商 | 240,000+专业观众 | 110+同期会议**

## 展馆主题分布图



### 同期展会

1-13号馆



#### 14号馆

- EDA工具/IP/芯片设计专区
- 先进封装
- 封装材料
- 半导体设备
- 半导体核心零部件
- AI应用特色展示区
- RISC-V 生态应用展示区

#### 15号馆

- IC制造及代工
- 光刻专区
- 半导体材料
- 晶圆制造/设备
- 半导体核心零部件

#### 16号馆

- 功率器件
- 半导体材料及设备
- 半导体核心零部件
- 国际展区
- 高校及科研院所专区

#### 16号馆

第23届  
**深圳国际电子展  
暨嵌入式展**  
elexcon 2026

领取参观证件



为方便您提前规划参观路线，特此整理了部分参展商企业：

领取参观证件

► **芯片及芯片设计/功率半导体：**中兴微电子、华润微电子、比亚迪半导体、爱特微、北京君正、澜起科技、紫光国微、广立微、复旦微电子、灿芯半导体、谱瑞集成、极海半导体、成都华微电子、国芯科技、算能科技、京微齐力、鸿芯微纳、珠海芯动力、进迭时空、隼瞻科技、六岳微电子、二进制半导体、乘翎微电子、达摩院玄铁、美创希、清芯智研、中德工业、华沅微、思凯迈、珈港科技、妙存科技、一微科技、智现未来、泰芯半导体、象帝先、智芯科、澜昆微、Advinno …；

► **晶圆制造及封装测试技术与服务：**华虹集团、积塔半导体、晶合集成、武汉新芯、增芯科技、华天科技、芯植微、佰维存储、时代民芯、锐立平芯、新核芯、安吉海万欣…；

► **半导体设备：**盛美上海、拓荆科技、华海清科、微崇半导体、华煜半导体、精测电子、北京中电科、中科飞测、隆友德、华卓精科、迈为技术、东方晶源、维嘉科技、三丰精密、容道社、冠礼科技、光粒半导体、理纯洁净、海目芯微、津上智造、钧华半导体、致和半导体、维嘉科技、微法尔、四元数、海汜半导体、艾恩、博涛智能、芯慧联芯、佳智彩、运泰利、伊创科技、幂帆科技、昌鼎电子、稳顶聚芯、华封科技、西斯特…；

► **半导体材料：**沪硅产业、天科合达、电科材料、安集科技、中船特气、上海新阳、清溢微、西陇科学、方大炭炭、木林升、奔朗新材、亦盛科技、中宝新材、贵研半导体、华熔科技、道川半导体材料、云升新材、昆吾、洽美斯、宇腾、晨日科技、玻芯成、欧莱新材、创格、基迈克、爱科迈、沃尔德、抚顺特钢、中色东方集团、YINCAE英凯…；

► **半导体核心零部件：**中科仪、新松半导体、万瑞冷电、上银科技、新莱集团、灿锐科技、司倍克、基恩士、冠业传动、四达全、星奇半导体、中科四点零、上可优、有氟密、百士吉、高川自动化、德利克、清能德创、兆默半导体、阿米精控、隐冠半导体、气立可、莫申、埃迈诺冠、雷赛、奕瑞、克洛诺斯、银光机器人、沈阳纪维、科瑞斯、横川机器人…；

► **科研院所及高校：**清华大学（集成电路学院）、上海集成电路材料研究院、深圳平湖实验室、广东省大湾区集成电路与系统应用研究院、上海交大无锡光子芯片研究院、中山大学集成电路学院、广州市香港科大霍英东研究院、深圳先进电子材料国际创新研究院、广东中科半导体微纳制造技术研究院、北京理工大学重庆微电子研究院、深圳理工大学、深圳技术大学集成电路学院、华南师范大学微电子学院、深圳职业技术大学集成电路学院…；

\*以上企业排名不分先后

## 多维度的参观资料

精心筹备系列**专业参观资料**—— 半导体高清产业链图、半导体设备/材料/零部件/芯片等细分技术维度的产品合集、提前解锁展会全貌的展前预览手册等。凭借这些参观资料，助您科学规划观展路线，实现高效精准的专业参观体验。**可扫码并添加至“我的小程序”，方便随时查看。**





## 主题展示区

[领取参观证件](#)

### ➤ AI应用特色展示区

#### ——从芯片到系统，重构AI算力与智能汽车基座 展位号：14C70

主办方携手内半导体领域的头部垂直媒体“芯师爷”共同打造特色专题展区，涵盖汽车电子、高性能算力、智能穿戴等三大主题板块，汇聚芯片、方案、终端三类展商，邀请核心展商现场拆解展品，聚焦核心芯片及零部件，技术人员同步讲解；设立沉浸式观众体验区，促进终端厂商与芯片、元器件厂商的深度沟通，解决上下游硬件关键环节的协同问题。

**参与企业：**京微齐力、极海半导体、六岳微电子、灿芯半导体、二进制半导体。



### ➤ RISC-V 生态应用展示区 展位号：14B50

IICIE携手漫话IC和芯片说IC TIME举办“RISC-V 生态应用展示区”，展区集结国内 RISC-V 领域标杆企业，集中展出处理器 IP、高性能算力芯片、软硬件平台及行业落地解决方案，完整呈现国产 RISC-V 从底层架构到实景落地的全链条生态实力。

**参与企业：**达摩院玄铁、清芯智研、中德工业、算能科技、国芯科技、隼瞻科技、进迭时空、芯际无限。



### ➤ 芯片及设计展示区 展位号：14B62

芯片及设计展示区覆盖算力 GPU、机器人主控、光电互连、存内计算 AI、物联网无线 SoC、音视频与模拟芯片、工业嵌入式存储、半导体智造工业软件多条核心赛道，全方位展示多元化国产芯片创新成果与一体化解决方案。

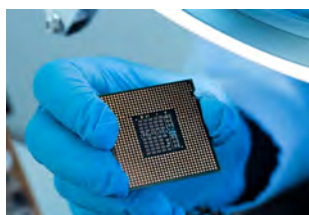
**参与企业：**智现未来、象帝先、一微科技、澜昆微、智芯科、泰芯半导体、合肥云联、安信达。



### ➤ IWAPS光刻展示区 15号馆

IWAPS 光刻展示区汇集光刻量测检测、精密光学、工艺热管理、光刻胶原料、设备清洗运维领域企业，覆盖曝光、图形检测、材料供应、设备保障全配套，展示支撑先进光刻工艺稳定量产的一体化解决方案，助力光刻工艺良率提升与技术迭代。

**参与企业：**赛默飞、爱德万测试、捷热科技、滴水微光、聚铭化工、锐越贸易、长沙艾森等。



### ➤ 高校及科研院所展示区 16号馆

集结国内顶尖半导体相关院校与科研机构的前沿成果，覆盖芯片设计、晶圆制造、封装测试等，是了解下一代半导体技术风向、挖掘早期优质技术成果的核心窗口。

**参与院所及高校：**清华大学(集成电路学院)、上海交大无锡光子芯片研究院、华南师范大学微电子学院、广东中科半导体微纳制造技术研究院、广东省大湾区集成电路与系统应用研究院、广州市香港科大霍英东研究院、中山大学集成电路学院、深圳理工大学、北京理工大学重庆微电子研究院、深圳职业技术大学集成电路学院、深圳技术大学集成电路学院、深圳先进电子材料国际创新研究院、珠海科技学院等。


[领取参观证件](#)



会议一览

[领取参观证件](#)

| 高峰论坛             |                                                        |                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 会议时间             | 会议地点                                                   | 会议名称                                     |
| 9月9日全天           | 14号馆馆内会议室-高峰论坛区                                        | 2026 IICIE国际集成电路创新博览会开幕式暨集成电路创新高峰论坛      |
| 9月10日全天          | 14号馆馆内会议室-高峰论坛区                                        | AI算力时代硅光产业峰会                             |
| 9月10日-11日        | 9月10日 南登录大厅二楼红树林厅A<br>9月11日 5号馆二楼5AB、6号馆二楼6AB、9号馆二楼9AB | IWAPS 国际先进光刻技术研讨会                        |
| 特色峰会             |                                                        |                                          |
| 会议时间             | 会议地点                                                   | 会议名称                                     |
| 9月9日下午 - 9月10日全天 | 13号馆二楼13A、13B                                          | 全球半导体分析师大会                               |
| 芯片及芯片应用          |                                                        |                                          |
| 会议时间             | 会议地点                                                   | 会议名称                                     |
| 9月9日下午           | 14号馆二楼14C                                              | 2026 RISC-V产业生态创新大会                      |
| 9月9日下午           | 14号馆馆内会议室                                              | 第三届AI赋能消费电子创新论坛                          |
| 9月10日上午          | 14号馆馆内会议室                                              | 端侧AI芯势力：2026智能终端芯片生态峰会                   |
| 9月10日下午          | 14号馆馆内会议室                                              | 智算之源：2026芯算力创新峰会                         |
| 9月10日下午          | 14号馆二楼14B                                              | 汽车芯片产业创新论坛                               |
| 9月10日全天          | 13号馆二楼13C                                              | 《Chip》芯片设计创新发展论坛                         |
| 9月11日上午          | 14号馆馆内会议室                                              | EDA与IP电子设计论坛                             |
| 9月11日上午          | 15号馆馆内会议室                                              | 第二届边缘AI与智能控制技术行业论坛                       |
| 半导体制造            |                                                        |                                          |
| 会议时间             | 会议地点                                                   | 会议名称                                     |
| 9月9日下午           | 13号馆二楼13C                                              | 先进材料创新发展大会<br>— 突破互连与散热极限-AI 异质整合封装之关键材料 |
| 9月9日下午           | 16号馆馆内会议室                                              | 半导体制造核心设备与零部件发展论坛                        |



会议一览

领取参观证件

| 先进封装    |              |                                                             |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 会议时间    | 会议地点         | 会议名称                                                        |
| 9月9日下午  | 14号馆二楼14B    | 2026中国MicroLED CPO产业链创新发展高峰论坛                               |
| 9月10日全天 | 14号馆二楼14C    | 先进封装与测试技术论坛<br>— 从 CoWoS 到 CoPoS：共探 AI 时代先进封装技术<br>演进与供应链布局 |
| 智能制造    |              |                                                             |
| 会议时间    | 会议地点         | 会议名称                                                        |
| 9月9日下午  | 15号馆馆内会议室    | 2026具身智能产业大会 ——从算力到执行，构建具<br>身智能系统                          |
| 9月10日全天 | 15号馆馆内会议室    | 智能工控赋能自动化创新论坛                                               |
| 绿色厂务    |              |                                                             |
| 会议时间    | 会议地点         | 会议名称                                                        |
| 9月11日上午 | 16号馆馆内会议室    | 半导体洁净厂务与能源管理论坛                                              |
| 宽禁带半导体  |              |                                                             |
| 会议时间    | 会议地点         | 会议名称                                                        |
| 9月10日全天 | 16号馆馆内会议室    | 宽禁带半导体技术与产业协同会议 ——SiC/GaN嵌埋<br>PCB装备及材料供应链专题                |
| 同期活动    |              |                                                             |
| 会议时间    | 会议地点         | 会议名称                                                        |
| 9月9日上午  | 14号馆二楼14B    | 第七届中德(欧)合作创新论坛——MEMS&微纳光学制<br>造                             |
| 9月9日下午  | 北登录大厅二楼媒体中心A | 第八届“复微杯”大学生电子设计大赛颁奖                                         |
| 9月9日下午  | 北登录大厅二楼媒体中心A | 示范性微电子学院产学研融合发展联盟理事会暨院长论<br>坛（闭门）                           |

\*会议以现场实际安排为准



## 晶圆制造及封装测试服务

[领取参观证件](#)

上海积塔半导体有限公司

15C58

### 先进逻辑工艺和数模混合工艺



提供多种嵌入式非易失性存储器 (eNVM) 技术, 技术节点覆盖0.35μm、0.15μm、0.11μm、40nm量产工艺, 以及28/22nm在研工艺, 为各工艺平台提供了可靠和高效的存储方案。

合肥晶合集成电路股份有限公司

15C55

### 提供HV、CIS、BCD、eNVM、Logic等多个技术平台晶圆代工服务

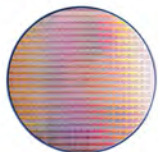


晶合集成已实现显示驱动芯片 (DDIC)、CMOS图像传感器(CIS)、微控制器(MCU)、电源管理(PMIC)、逻辑应用 (Logic) 等各类产品量产, 应用涵盖消费电子、智能手机、智能家电、安防、工控、车用电子等领域, 可为客户提供丰富的产品解决方案。

武汉新芯集成电路股份有限公司

15D42

### 新芯股份三维集成晶圆

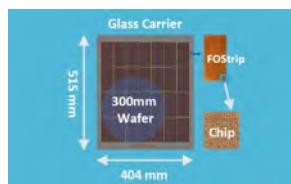


新芯股份拥有国际领先的晶圆级三维集成技术, 已构建双晶圆堆叠、多晶圆堆叠、芯片-晶圆异构集成和硅转接板2.5D Interposer等晶圆级三维集成代工平台, 可显著降低延时、降低功耗、减小尺寸等, 为后摩尔时代全新架构的芯片系统提供创新解决方案。

青岛新核芯科技有限公司

14B108

### 扇型玻璃基板封装 (FOStrip®)

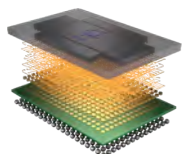


新核芯扇型玻璃基板FOStrip® 利用面板级玻璃基板 (PLP) 进行重布线层 (RDL) 制作, 再将玻璃基板裁切成条状 (Strip), 适用后段既有封装设备生产。

华天科技

14C72

### Wafer Level Package Platform

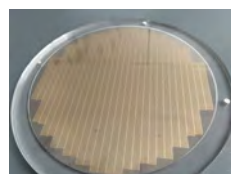


FOPLP: 华天自研的HGemini 板级扇出技术。FOWLP:具备8寸、12寸晶圆级扇出封装能力。

浙江芯植微电子科技有限公司

14C80

### 高端先进封装及晶圆测试服务

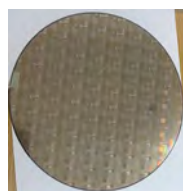


浙江芯植微电子科技有限公司聚焦高端先进封装, 以中段制程 (MEOL) 与CP测试为核心, 提供面向2.5D/3D异构集成的“晶圆到芯片”一站式服务。公司拥有嘉兴、舟山双基地, 具备金/铜镍金凸块 (Bumping) 及高密度RDL量产能力, 年产24万片。凭借“设备、材料、工艺”三位一体的创新优势, 全面赋能显示、存储、HPC等前沿市场。

锐立平芯微电子 (广州) 有限责任公司

15C23

### 12寸FDSOI晶圆制造



具有高性能、低功耗、高可靠性等特点, 可广泛应用于汽车电子、移动通信、物联网、可穿戴设备等新兴领域。

北京时代民芯科技有限公司

14B67

### 高可靠集成电路封装及检测技术服务



公司致力于为客户提供高性能的集成电路产品、高品质的封装测试服务以及全方位的技术支持, 现已构建可编程射频芯片、多通道收发器与频钟芯片、数字信号处理芯片、总线与网络芯片、传感器处理芯片、系统级集成芯片等产品线, 拥有技术先进的高可靠集成电路和系统级封装测试平台, 覆盖商业航天、汽车芯片等国家战略性新兴产业市场。



## 半导体设备——制造设备

[领取参观证件](#)

拓荆科技股份有限公司

15B66

### PF-300M Supra-D PECVD设备



PF-300M 系列产品可搭载 5 个反应腔，满足客户对不同工艺和膜厚的高效需求。该平台兼容PECVD高端产品pX、Supra-D，以及 PEALD Astra 反应腔。PF-300M Supra-D 系列产品是面向先进制程的新一代高端产品，采用全新的独立腔室设计，以优异的薄膜稳定性、均匀性、颗粒度表现实现更严格的工艺指标要求。

拓荆科技股份有限公司

15B66

### VS-300T Astra-s ALD设备



VS-300T 为拓荆自主研发的ALD原子层沉积设备。VS-300T 系列产品可搭载4个反应腔，结构紧凑，同时满足高产能需求，具有优异坪效比及CoO。该系列产品可沉积高质量的SiO<sub>2</sub>、SiN<sub>x</sub>、TiO<sub>2</sub>薄膜，在均匀性、颗粒度、台阶覆盖率等方面达到国际领先水平，满足逻辑、存储等客户先进技术节点要求。

华海清科股份有限公司

15A48

### 化学机械抛光机 Universal-300FS



Universal-300FS是华海清科推出的面向先进制程的化学机械抛光机，它是单头搭配单盘的抛光系统，具备8个独立气压分区的抛光头，同时集成多种实时检测技术，搭载抛光垫智能修整技术，适配垂直擦洗技术和提拉干燥技术，实现超洁净清洗，满足先进制程需求，应用于逻辑芯片、存储芯片、先进封装、大硅片、功率器件、图像传感器等领域。

华海清科股份有限公司

15A48

### 中束流离子注入机 iHQ-900E



该装备具备卓越的离子束角度精度和束形控制能力，可稳定保障晶圆注入剂量高精度；整机采用先进的三磁铁架构，该机型适配多类高端芯片制造场景，适配FinFET 逻辑器件，DRAM、3D NAND 等存储芯片量产制程；同时依托优异的金属污染表现性能，可满足CMOS 图像传感器严苛的制造要求；搭载高温注入工艺模块，可实现SiC 功率器件掺杂工艺需求。

江苏容道社半导体设备科技有限公司

15B77

### 光刻机



容道社自主研发的 RPA-600 投影式光刻机具备以下核心性能：精密光刻能力分辨率达 1.5μm，焦深 (DOF) 6-8μm，套刻精度 3σ ≤ 0.6μm，光强均匀性 <3%，数值孔径 (NA) 0.158，支持 I-line (365nm)、H-line (405nm)、G-line (436nm) 多波段曝光。兼容 5/6/7英寸掩模版与 4/5/6英寸晶圆，标准产能 100 WPH (片/小时)。紧凑设计：<4m<sup>2</sup> 占地面积，显著降低洁净室空间成本。

深圳市海目芯微电子装备科技有限公司

15B68

### 光芯片光刻机



光芯片光刻机属行业专用光刻设备，对准精度高，可适配多种晶圆材料；设备支持高精度双面对准工艺，BSA 对准精度 2μm、TSA 对准精度 1μm；配备真空接触、软接触、硬接触、接近式等多种曝光加工方式；搭载自研高准直平行光光源，线宽分辨率可达 1μm，满足高精度光芯片制程需求。

北京微法尔半导体科技有限公司

15B30

### 晶圆分选设备



晶圆分选设备搭载微法尔自研晶圆传输核心部件，支持多晶圆尺寸、多Port间的晶圆高速互传，根据不同应用需求可搭载 SEMI标准的FOUP、FOSB、OpenCasette、Smif Pod等装载单元，亦可实现装载单元的混搭配置。

深圳市四元数半导体有限公司

16A35

### MA-400 全自动双面 对准光刻机



全自动双面对准光刻机为单工位设备，兼容 2-8 寸晶圆、4-9 寸光刻版，正面套刻精度 ±0.5μm、背面对准 ±1μm，可精准完成双面图形对准。整机功率 6.0KW，自重 1300kg，碎片率低于十万分之一，可连续 144 小时无故障运行。



## 半导体设备——制造设备

[领取参观证件](#)
**无锡海昶半导体科技有限公司**
**15B75**

### 晶圆甩干机



设备类型：立式旋转甩干机 晶圆尺寸：100mm~200mm 作业方式：全自动 设备配置：立式单桶/双桶；转速300-3000转/分钟；氮气密封；伺服马达控制；水电阻率检测；氮气加热；除静电装置；安全联锁；支持SECS/GEM通讯协议 工艺指标：颗粒控制能力，增加值<30颗@0.2微米 可靠性：Uptime≥95%；MTBF≥2000 hours；MTTR≤3 hours。

**艾恩（山东）半导体科技有限公司**
**15A71**

### 离子注入机



公司产品覆盖碳化硅高温注入机、硅基中束注入机，即将推出大束流注入机，规划三年内实现全机型覆盖。核心技术包括全自研正向设计、95%以上零部件国产化，生产效率提升1.5倍，提供快速响应的本地化服务。 主要面向第三代半导体（SiC）、硅基集成电路、MEMS传感器及功率器件等领域。

**江苏博涛智能热工股份有限公司**
**15B15**

### ALD镀膜设备



ALD-TG 系列为公司自主设计研发的产品系列，该 Batch 原子层沉积设备可用于集成电路及 Micro-LED 显示的生产，兼容 12 寸、8 寸及以下晶圆，主要用于氧化物薄膜（氧化铝、氧化钛、氧化硅）的原子层沉积，可延伸至其它氧化物薄膜，可按需定制。

**深圳稳顶聚芯技术有限公司**
**15D55**

### 步进投影光刻机



WS180i系列步进投影光刻机主要应用于 mini/micro LED、光电器件、光芯片、功率器件等化合物半导体领域，可满足硅片、蓝宝石、sic等衬底的不同胶厚光刻工艺需求。 支持硅基、GaN基、SiC基等不同材质化合物基底 产率：90 ~ 150wph 套刻精度 ≤200~350nm 产品型号WS180i1 WS180i2 WS180i3 WS180i-C WS235i 分辨率 0.8μm 0.8μm 1-1.5μm 1μm 0.35μm。

**合美半导体（苏州）有限公司**
**16B73**

### HS系列研磨抛光机



HS系列机台是一款操作便捷，兼容性强的 高效能磨抛机，通过搭载不同材质磨抛盘及不同规格夹具可以兼容多种磨抛工艺。可实现一个终端控制多台主机，实现多机联控。并可选择无线或有线方式控制主机。可选配增至3通道进料系统。抛光液流速控制范围0-200ccm。

**北京科翰龙半导体装备科技有限公司**
**15B33**

### 晶圆激光打标机



用于2" ~8"、12" 晶圆Wafer ID Marking及 Die Marking 适用于Si、SiC、InP、LT、LN、GaN、玻璃等多种晶圆：支持符合SEMI标准的Wafer ID码 配备用户可选CHECKSUM功能 支持晶圆软打码或硬打码工艺 可选配背面或双面打标功能 可选配键合晶圆及2.5D/3D翘曲晶圆 具备SECS/GEM标准通讯协议 可选配 FOUP Load Port或 SMIF Load Port 可与天车、AGV小车等AMHS系统无缝对接。

**江西程和科技有限公司**
**14D10**

### 9b-5/10高精双面研磨抛光设备



专为超薄精密加工打造。该系列涵盖5盘与10盘机型，最大加工直径达Φ150mm，厚度范围0.15-60mm，轻松应对半导体及光学元件的极限加工需求。设备采用电动同步升降与伺服驱动游星轮定位，配合涡轮蜗杆减速机及多电机独立驱动，确保运行平稳高效。其核心优势在于实时恒压力闭环控制（120-1500N）与精细转速调节，结合日本THK轴承、高精度主轴及可选配的SONY在线测厚仪，实现了微米级的高精度与一致性，是高端制造的可靠选择。

**北京东之星应用物理研究所**
**14D90**

### 快速退火炉



温度范围：100 - 1300 °C 升温速率：2 - 200 °C/秒可调 样品最大尺寸：4-12英寸。



## 半导体设备——封装设备

[领取参观证件](#)

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

15B50

### 面板级先进封装电镀设备



该设备针对半导体制造过程中面板级封装环节的技术难题，提出了创新性的解决方案，可用于RDL的Cu电镀以及bump，Cu/Ni/SnAg的电镀。该设备采用盛美上海自主研发的水平式电镀确保面板具有良好的均匀性和精度，避免了电镀液之间的交叉污染，提升芯片质量的同时提高了效率并降低了成本。

苏州华煜半导体设备科技有限公司

14D70

### 晶圆级芯片分选编带机



通过集成高精度六面视觉检测与高速定位技术，实现晶圆切割后芯片的全自动六面缺陷筛查、精准分选及高效编带，确保高良率芯片的稳定输出。

北京中电科电子装备有限公司

14D40

### WGP-1271全自动减薄抛光一体机



300mm 晶圆高效一体化设备，集成减薄、抛光、撕贴膜功能，适配先进封装 50μm 以下超薄晶圆加工。采用三主轴四工位布局，集成粗磨、精磨、抛光全工艺能力，第三轴支持干式抛光等特殊应用；搭配 Swing NCG 与 Auto TTV 联动系统，全程非接触无损测厚并实时调整，实现超薄晶圆稳定量产。

北京中电科电子装备有限公司

14D40

### WG-8501全自动减薄机



面向 8 英寸及以下硅、碳化硅、砷化镓等多种材料的晶圆减薄。搭载粗磨磨痕轨迹重合技术，可实现 8 英寸晶圆 100μm 以下精密减薄；双主轴三工位设计，配备在线测量单元精准控厚，搭载 8 英寸超精密空气主轴与气浮载台，具备 SECS/GEM 联网功能，适配化合物半导体与通用硅基产线。

深圳隆友德科技有限公司

14D80

### 卧式磁控溅射生产线



洁净真空度:  $\leq 5 \times 10^{-5} \text{Pa}$   
温控室温:  $\sim 150^\circ\text{C}$  (低温制程)  
膜厚均匀性:  $\leq \pm 5\%$   
特殊功能: 支持真空内双面镀膜; 可搭载 Hipims+偏压  
兼容靶材: Ti、Cu、Ni、Au 等多靶材多层膜沉积  
适用场景: 适配 FOPLP 封装, 大批量 RDL 种子层、车规级芯片 EMI 屏蔽、大尺寸载板及金刚石铜规模化金属化”  
核心优势: 流水线锁气量产架构; 多层膜连续沉积; 防交叉污染设计;  
量产高稼动率; 绿色环保

深圳隆友德科技有限公司

14D80

### 立式单面双面磁控溅射生产线



洁净真空度: 洁净真空度  $\leq 5 \times 10^{-5} \text{Pa}$   
温控室温:  $\sim 150^\circ\text{C}$  (低温制程) 片内膜厚均匀性:  $\leq \pm 5\%$  特殊功能: 支持真空内双面镀膜; 可搭载 Hipims+偏压兼容靶材: Ti、Cu、Ni、Au 等多靶材多层膜沉积适用场景: 适配 TGV 玻璃基板、金钢石衬底、晶圆、精密载板 柔性一体机多用; 绿色生产。

北京华卓精科科技股份有限公司

15B45

### 混合键合设备 HB ORI®



HBS 系列全自动晶圆混合键合系统是自动化程度、集成度很高的满足混合键合要求的键合设备, 集成了键合工艺的多个功能模块, 真正实现了室温的直接键合工艺。

迈为技术（珠海）有限公司

15A52

### 3D封装成套工艺设备解决方案



以混合键合设备为基础，公司首创性开发了 3D 封装成套工艺设备解决方案，覆盖晶圆研抛、飞秒激光表切、等离子体切割、晶圆激活、混合键合 (D2WW2W) 等关键设备，将半导体集成与新型显示技术创新融合，助力客户实现更小互连间距、更高堆叠层数的制造工艺，可为 AI+AR 眼镜等智能产品的升级与应用提供支撑。



## 半导体设备——封装设备

[领取参观证件](#)

苏州维嘉科技股份有限公司

14D60

### 晶圆级分选机

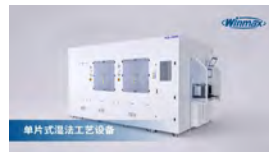


AI视觉 高识别率AI视觉检测技术 高速高效 高速高响应分选控制系统 配置丰富 模块设计, 超高互换性。

苏州冠礼科技股份有限公司

16B40

### 高阶湿制程工艺设备



单片式湿法工艺设备: 1.多层CUP腔体架构, 可于单腔内实现双药液蚀刻与清洗工艺。2.零交叉污染设计:腔体结构有效隔离药液并提高药液回收率。3.可编程喷嘴手臂:实现更高的蚀刻均匀性与工艺稳定性。槽式湿法工艺设备: 1.模块化灵活配置, 满足多样化工艺需求, 同时实现低占地面积 (Low Footprint), 最大化厂房空间利用率。2.搭配EFFM及干燥设备, 全自动干进干出工艺, 避免晶圆氧化与二次污染。3.高精度晶圆传送, 保障工艺。

广东光粒半导体设备有限公司

14A48

### 全自动压缩成型塑封机(固态)



该设备是通过自动上板, 自动撒粉装置, 将待塑化的材料送入模腔中的模具表面, 经过设备加热固化后, 在模具腔内实现压缩成型封装方法的全自动化设备。

苏州钧华半导体技术有限公司

14C62

### 单晶圆水平电镀设备 (2.5D TSV)



单晶圆水平电镀设备, 应用于晶圆级封装电镀工艺, 可全自动作业, 并配备 Loadport和EFEM, 干进干出, 兼容8寸/12寸等不同尺寸的晶圆, 可以实现电镀多种金属层; 软件为自研设计, 工艺均有上位机主导控制, 满足半导体SEMI标准, 符合SECS/GES协议。

芯慧联芯(江苏)科技有限公司

15B62

### W2W混合键合设备



基于正向设计的自主研发, CANOPUS系列混合键合设备关键性能指标达到国际同类产品领先水平, 支持预对准、实时对准、活化、清洗、量测、解键合等多模块一体化集成。

幕帆科技(上海)股份有限公司

14D45

### 压力/真空 烘箱



用于半导体制程中需要去除各种气泡的应用环境。通常应用于 underfill 点胶, DAF, memory 产品 立体叠装DIE。通过惰性气体 加压装置, 实现温度-压力-气氛-时间四维空间的精准耦合, 可在正压/高真空环境下完成工艺, 适配半导体先进封装等高端场景, 避免传统烘箱易出现的空洞率、焊料润湿不均等问题。

深圳联得半导体技术有限公司

14B38

### COF倒装共晶设备 (ILB设备)



COF倒装共晶设备是一款高精度倒装芯片键合设备, 是国内首台自主研发的面向显示驱动芯片键合工艺的高精度倒装设备, 通过高速度高精度倒装共晶键合工艺, 将显示驱动芯片凸点与柔性基板引脚实现细间距高密度互联, 提高IC封装密度和性能, 芯片贴装精度1.5μm, 该设备广泛应用于LCD/OLED显示驱动芯片等先进封装测试领域, 是该领域的关键封装设备。

苏州美图半导体技术有限公司

14A10

### 阳极键合机



阳极键合是一种通过加热并在直流电场作用下实现玻璃与金属(或半导体)键合的工艺。该工艺利用外加电场促使玻璃中的阳离子(如Na<sup>+</sup>)发生迁移, 从而在玻璃-硅界面附近形成空间电荷区, 产生静电力使两者紧密接触。在适当的温度与电场共同作用下, 玻璃中的氧离子与硅表面原子之间形成牢固的氧-硅共价键, 从而实现两种材料之间的永久键合。

12



## 检测及测试测量设备&仪器

[领取参观证件](#)

上海微崇半导体设备有限公司

15B40

### 二谐波晶圆检测设备 ASPIRER3000



产品是一款高精度二谐波晶圆检测设备，采用国内首创的二谐波晶圆检测技术，通过激发、采集晶圆产生的二谐波信号检测其电学与晶格特性，实现对晶圆电学性能、薄膜质量、表面质量以及材料质量等方面的全面检测，实现高精度、高效率的晶圆检测，支持检测多种材料，实现在线监测，适用于多种器件、工艺及制程。

深圳中科飞测科技股份有限公司

15A50

### 三合一图形晶圆缺陷 检测设备系列



该系列设备主要应用于晶圆表面亚微米量级的二维、三维图形缺陷检测，能够实现在图形电路上的全类型缺陷检测。拥有多模式明/暗照明系统、多种放大倍率镜头，适应不同检测精度需求，能够实现高速自动对焦。适用于集成电路前道和先进封装领域。

东方晶源微电子科技（北京）股份有限公司

15B58

### 电子束缺陷检测设备EBI



电子束缺陷检测设备（Electron Beam Inspection, 简称 EBI），应用电子束扫描技术对晶圆表面进行高分辨率成像，通过智能算法检测出晶圆上的电性和物理缺陷，是芯片制造过程中良率提升的关键设备。

三丰精密量仪（上海）有限公司

15B55

### 搭载白光干涉、近红外镜头的影像测量机 QVWLI-NIR



搭载白光干涉、近红外光源的影像测量仪。可使用白光干涉进行非接触式高精度细微表面形状测量、粗糙度测量；近红外光源可透过层间材料(ABF等)和焊料抗蚀剂测量多层PCB板的试样，观察、测量层间材料内配置的内置部件，无需激光打孔可减少工序，因此不用担心激光损伤试样，为半导体行业解决封装检测难题。

津上智造智能科技江苏有限公司

15D48

### 超声波扫描显微镜 UTSCAN400



超声波扫描显微镜SAT是我们公司纯自研设备，包括整体硬件、UI界面、扫描软件和分析软件。对物体内部结构进行扫描成像，做到不破坏产品检查芯片等内部缺陷。设备整体性能和指标可以完全替代进口品牌，在操作简洁方便性、对图像的缺陷分析以及客制化需求上优于进口品牌。

苏州佳智彩光电科技有限公司

15A42

### OCS-LCD光开关外观 检测



通过背光点亮LCD方式，相机拍照检测其表面和液晶层缺陷，分析缺陷规格，自动分选下料。主要检测内容：表面缺陷：划伤、破损、崩边、脏污、异物等 液晶层：气泡、异物、亮度不均等 特点：高精度成像：搭载65M面阵工业相机飞拍成像，精度可达3um 背光系统：可编程的高均匀性背光源，提供稳定、可控的背光 软件分析：视觉软件通过算法AI大模型对图像实时分析，自动识别并分类缺陷。

珠海市运泰利自动化设备有限公司

14A43

### 通用型X射线检测设备



设备介绍：具备2D,2.5D,3DX射线检测能力，可广泛应用于电子元器件、MEMS、PCBA、半导体芯片、新能源行业产品内部缺陷的检测。

无锡昌鼎电子有限公司

14A72

### 高温测试打印编带一贯机



适用产品：PDFN, SOP, DFN, SOD, SOT, TO, MSOP, SMX series; 适用于需要高温测试、常温测试的半导体器件做测试、分选、编带作业。使用高精度零部件和日本进口DDR马达确保稳定性和高UPH产出，整合打标系统和影像系统。



## 检测及测试测量设备&仪器

领取参观证件

广州伊创科技股份有限公司

15D18

### 875 SupLab 全自动电位滴定仪



875 SupLab 全自动电位滴定仪适用于全厂湿化学工艺流程中关键组分含量的滴定分析。仪器采用模块化硬件设计，搭配具备多种自定义功能的软件平台，可根据用户实际使用需求灵活搭配各类检测模块。

上海骄成超声波技术股份有限公司

15A87

### Wafer400-F2先进封装超声扫描检测系统



用于2.5D/3D封装D2W、W2W键合后气泡缺陷检测，兼容6、8、12寸晶圆，全自动机型，双工位，带自动翻转功能。

拓界（西安）光电科技有限公司

14A35

### 超景深显微镜



MX-E1超景深数码显微镜，是集成高清显微观察、高清影像拍摄、智能精准测量三大核心功能于一体的专业精密检测设备。操作便捷高效，无需复杂调试即可快速完成观测、成像与数据测量，为工业生产与科研工作提供高精度、高效率、高便捷性的微观观测解决方案。

合肥巨阙电子有限公司

14A75

### 导通电阻测试系统（手提式）



本装置主要是评估印刷电路板和导通材料间的电路和焊点间正确性和可靠性，通过对待测点细小阻值连续监测，可准确评估印刷电路板材料、汽车电子材料、半导体封装和电子元器件连接处可靠性。可独立量测或与环境腔室集成使用，可搭配热油试验机、高低温试验箱、冷热冲击箱等进行耐久性测试。

惠然微电子技术（无锡）有限公司

15D08

### 关键尺寸量测设备 CD-SEM



惠然微电子关键尺寸量测设备（CD-SEM）利用先进的电子束扫描成像技术，对光刻胶线条宽度或蚀刻后栅极线条宽度进行关键尺寸的在线测量，并与设计尺寸实时对比从而实现关键工艺参数监控，是提高芯片制造良率、维持产品质量一致性的关键设备。主要应用于显影后光刻胶的临界尺寸测量及蚀刻后接触孔直径、通孔直径个栅极线条宽度测量。

杭州睿影科技有限公司

16A81

### 在线3D AXI智能检测设备



在线3D AXI智能检测设备基于不同材料厚度对X射线的吸收差异，设备通过对物体进行3D X-Ray成像，并根据内部切层信息进行缺陷检测。设备不仅能够实时观测到被检物内部高清切层图像，也可以查看3D渲染后的三维成像，并依此判定被检物内部是否存在缺陷，缺陷类型和缺陷等级。

东莞市中旺精密仪器有限公司

16B55

### A8-SinoVision-442 龙门超高精度全自动影像测量



A8-SinoVision是一款龙门全自动影像测量仪产品，专为高精度测量而设计。广泛应用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、精密冲压、接插件、连接器、手机、家电、印刷电路板、医疗器械、钟表、刀具、军工、电力、桥梁、船舶、航空航天等各行各业精密测量，最终达到品质管控目的。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

14B07

### 超景深3D数码显微镜



超景深3D数码显微镜1160系列产品，内置1200万像素相机和光学镜组，支持30-6000倍全范围倍率的自动切换；拥有强大的超景深合成和图像拼接算法，可以满足大体积样品的观测需求和超大面积的拼接尺寸，集成多维测量功能，满足各类2D、3D拼接需求，可以实现高质量、高分辨的图像观测，同时还拥有丰富的测量功能，这款设备可广泛应用于半导体、3C、锂电、汽车等多个领域。

14



## 半导体材料

[领取参观证件](#)

上海硅产业集团股份有限公司

15C75

### 半导体硅晶圆

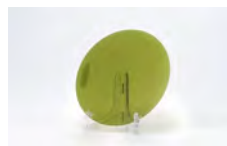


公司提供的产品类型涵盖300mm抛光片及外延片、200mm及以下抛光片、外延片及SOI硅片。产品主要应用于逻辑与存储芯片、图像处理芯片、通用处理器芯片、传感器、射频芯片、模拟芯片等领域。

北京天科合达半导体股份有限公司

16B60

### 8英寸导电型碳化硅衬底



8英寸碳化硅衬底因其有效利用面积与6英寸相比提高接近90%，外延和晶圆制造成本增加不明显，且制程较6英寸更为先进等因素，可有效降低单个器件成本，在未来具有广阔的增长空间。天科合达目前已掌握高质量8英寸导电型碳化硅衬底制备的关键技术。目前取得的部分技术成果如下：低微管密度控制技术；低位错密度控制技术；电阻率均匀性控制技术。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

15C68

### 铜化学机械抛光液



安集科技的铜及铜阻挡层化学机械抛光液，用于集成电路制造工艺中铜互连的平坦化，产品已在逻辑芯片、存储芯片等制程上量产使用，持续研发并验证用于下一代技术节点用的产品。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

15C70

### 三氟化氮



半导体制造用高纯度氟化气体 电子级三氟化氮（NF<sub>3</sub>）是一种常温常压下呈无色透明的有毒气体，分子量为71.002，沸点为-129.06℃。该气体在微电子工业中主要用于等离子蚀刻工艺，其分解产生的活性氟离子可对硅、氮化硅等材料实现高选择性蚀刻且无残留。

上海新阳半导体材料股份有限公司

15C80

### ArF 光刻胶



公司 KrF 光刻胶目前已有多型号产品实现小批量、持续销售。同时原料开发工作也取得阶段性成果，原料树脂的合成方案探索、工艺优化、稳定性等方面都取得突破。ArF 浸没式光刻胶的研发进展顺利，已在国内多家晶圆制造企业开展。

中电科半导体材料有限公司

16A58

### N型SIC衬底

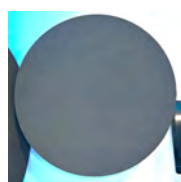


碳化硅具有高击穿场强、高热导率、高电子饱和速率、高抗辐射能力等优越性能，是固态光源和电力电子、微波射频器件的“核心”，在半导体照明、新一代移动通信、智能电网、高速轨道交通、新能源汽车、消费类电子等领域有广泛的应用。产品包括：4~12英寸高纯半绝缘碳化硅衬底、4~12英寸N型碳化硅晶体及衬底。

成都方大炭炭复合材料股份有限公司

16A52

### 多孔石墨



多孔石墨，具有开孔率高、强度高、孔径分布窄、结构均匀等特性，广泛应用于半导体、电池、催化剂、氢气储存、吸附材料等领域。

西陇科学股份有限公司

16C59

### 高纯湿电子化学品



西陇科学稳定量产供应，纯度可达G1-G5级别的通用型湿电子化学品：酸碱类如硫酸、盐酸、硝酸、氨水等；清洗剂（有机溶剂）如甲醇、乙醇、异丙醇、丙酮等；正胶稀释剂；功能型湿电子化学品：包括显影类（正胶显影液、负胶显影液）、蚀刻类（铜蚀刻液、ITO蚀刻液、BOE缓冲蚀刻液等）、剥离液（正胶剥离液、负胶剥离液）；去毛刺液等产品。

15



## 半导体材料

[领取参观证件](#)

江苏木林升新材料有限公司

15D85

### 高纯硫酸铜溶液



木林升的高纯硫酸铜溶液，专为高端半导体电镀、PCB微孔沉积及先进封装等精密电子应用而设计。溶液以精确控制的铜离子和硫酸浓度为基准，结合极低的金属杂质、总有机碳（TOC）及颗粒物含量，显著提高镀层的均匀性、结合力和可靠性，适用于对杂质敏感的高精度电镀制程。

广州亦盛新材料科技有限公司

15D52

### 半导体晶圆切割液



主要用于各类晶圆片、LED、硅片等各类材质的切割，产品具有很好的润滑性和清洁性，专注于减少制程工艺中的静电堆积、锯末颗粒污染，有良好的污垢分散能力以及抗静电能力，切割后的颗粒物不会粘附在产品上，润滑清洁效果优异，对工件无腐蚀，安全且绿色环保，能有效提高加工精度，提升加工效率，提高切割质量。

深圳中宝新材料科技有限公司

14C27

### 键合金丝



键合金丝（Bonding Wire），也叫半导体焊线、引线键合丝，是芯片封装核心耗材，用于芯片焊盘与外部引脚 / 基板之间的电气连接，靠热压 / 超声热压工艺实现金属熔接导通，是芯片电流、信号传输的桥梁。

贵研半导体材料（云南）有限公司

15C100

### 高纯金及合金蒸发材料



贵金属键合丝是芯片封装的关键基础材料，主要包括键合金丝、银合金键合丝、镀钯铜丝等，目前综合产能达到26吨/年，产品稳定供给国内龙头半导体芯片制造与封装企业。

广东奔朗新材料股份有限公司

15D62

### 精密研磨抛光材料



包括金刚石研磨液、氧化铝抛光液、CMP抛光液等，主要用于光学玻璃、蓝宝石、硅片、碳化硅晶圆等材料表面的精密研磨和抛光。

道川半导体材料（杭州）有限公司

14C19

### ETFE 氟聚合物薄膜

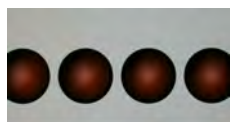


高性能ETFE分离膜具备优异的化学稳定性、优异的离子力、高透光性、机械强度以及耐热性能。适用作半导体存储封装和LED封装的释放膜。凭借其卓越的延展性和柔韧性(延伸率高达350%)，它能够满足各种封装应用的需求。

山东云升新材料有限公司

14C62

### YS-P6530系列正性光刻胶

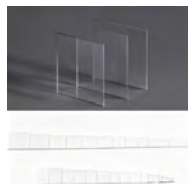


YS-P6530系列为正性光刻胶，应用于湿法、干法刻蚀和金属电镀工艺，耐受性好，去胶容易。超厚膜，高对比度，高感光度正性光刻胶，适用于半导体制造及热回流工艺。产品亮点：高对比度，高感光度、高附着性，对电镀工艺高耐受性高选择刻蚀比、膜厚均一性好、热回流效果好。

昆吾先进材料（江西）有限公司

14C42

### 单晶金刚石超薄片



单晶超薄片热导率可达2300w/(m·k)，厚度50-100um。核心应用于电子散热、光学电子与光学器件、芯片封装与精密制造，可提供多种尺寸规格的高质量CVD单晶金刚石超薄片产品。

领取参观证件

14A13



15C108

16C75

15C107



14C21



14C59

14C49



15C88



**IIICE** 国际集成电路创新博览会  
INTERNATIONAL INTEGRATED CIRCUIT INNOVATION EXPO



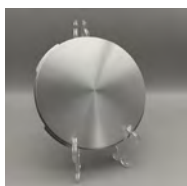
## 半导体材料

[领取参观证件](#)

宁夏东方钽业股份有限公司

15C119

### 12英寸钽靶坯



12英寸钽靶坯实现纯度 $\geq 5N$ 、晶粒尺寸波动控制在 $\pm 15\mu m$ 以内，织构组份{111}与{100}比例实现自主可控，已通过国内外客户认证并实现批量供货，构建了从矿石、氟钽酸钾、高纯钽粉、高纯钽锭到钽靶坯的完整自主产业链，形成了全流程可控的供应体系。

奥芯半导体科技（太仓）有限公司

14C77

### 封装基板



IC载板具有高密度布线、阻抗小、接点多、优异高频信号传输性能和机械强度等核心优势，是高性能计算芯片、服务器芯片、网络通信芯片等关键元器件的必备封装材料。没有IC载板，高性能芯片无法稳定高效工作，凸显其不可替代的重要性。

浙江华熔科技股份有限公司

16B75

### 超高纯等静压石墨制品

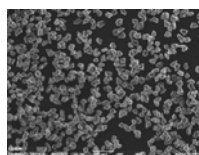


超高纯等静压石墨制品，晶体生长石墨件，外延、MOCVD石墨潘，离子注入石墨件

河南万磨金刚石有限公司

16A63

### 划片刀专用微粉

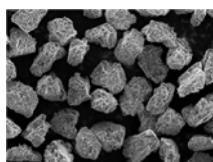


兼顾切割效率与切割质量的平衡，提升切削性能，平衡使用寿命，适配颗粒特性，降低崩边风险，适配特殊要求。

东莞市柯林奥半导体材料有限公司

16D75

### 金刚石研磨液



拥有单晶/聚晶和类多晶/多晶四种不同类型的金刚石研磨液。金刚石研磨液精选优质金刚石微粉，复合分散剂和分散介质组合而成，配方多样化，对应不同的研和不同材质的加工工件，适应性强。主要特征有分散性好，不易沉淀，粒度均匀，研抛效果稳定，润滑性优异，酸碱均衡，不损伤工装。

驰道科技（苏州）有限公司

14C48

### 陶瓷基板



产品耐高温、抗热震、化学稳定性优异，可耐受窑炉快速升降温冲击，不开裂、不炸裂，无杂质析出，避免污染烧结物料。科学的卡槽结构便于多层堆叠，提升装载效率，降低破损率，可多次循环使用，有效降低客户综合成本。

深圳市大分子科技有限公司

14C46

### 正性PSPI光刻胶



正性 PSPI 即正性光敏聚酰亚胺光刻胶，曝光区遇碱显影液溶解，图案和掩膜一致。依托聚酰亚胺骨架，耐高温、低介电、耐化学腐蚀，分辨率优于负性 PSPI。经涂覆、曝光、碱显影、高温固化成绝缘薄膜，多用于芯片先进封装、OLED 像素界定、MEMS 平坦化与应力缓冲层，是高端微电子关键介质材料。

中硅半导体（扬州）有限公司

15C06

### 单晶硅片



采用超高纯度单晶原料加工，是半导体器件、芯片及太阳能电池核心衬底。自有研磨、抛光、无尘完整产线，可提供标准及定制化硅片，适配科研、流片、光伏等场景。规格覆盖直径 1-12 英寸，可选 $\langle 100 \rangle$ 、 $\langle 111 \rangle$ 、 $\langle 110 \rangle$ 晶向；导电分 N 型、P 型、高阻绝缘型；厚度 $100\mu m-10mm$ ，可单 / 双面抛光；电阻率 $0.001-10000\Omega \cdot cm$ 区间可调。



## 计算与通信

[领取参观证件](#)

深圳华强半导体集团有限公司

14A70

### 昇腾边缘AI智算系统



本边缘 AI 智算系统是为具身机器人等场景设计的一款多接口，高性能主机。搭载了华为昇腾310P 芯片，算力高达176 TOPS，适应复杂的工业环境应用。

深圳华强半导体集团有限公司

14A70

### 昇腾边缘AI智算系统



本边缘 AI 智算系统基于昇腾 AI NPU 研发，提供 8 TOPS INT8 算力，支持图像、音视频多源数据实时分析与 AI 推理。

澜起科技股份有限公司

14B52

### 时钟芯片



澜起科技凭借在数模混合芯片设计、核心 IO 技术和 PLL 模块等关键技术上的深厚经验，成功布局高性能时钟芯片市场，提供时钟发生器、时钟缓冲器和展频振荡器系列时钟芯片解决方案。该系列产品可广泛应用于数据中心、通讯电子、消费电子、医疗电子、汽车电子等领域，满足行业对高性能时钟芯片日益增长的需求。

澜起科技股份有限公司

14B52

### PCIe® Retimer芯片



澜起科技的PCIe® Retimer系列芯片，采用先进的信号调理技术来补偿信道损耗并消除各种抖动源的影响，从而提升信号完整性，增加高速信号的有效传输距离，为服务器、存储设备及硬件加速器等应用场景提供可扩展的高性能PCIe®互连解决方案。

达摩院玄铁

14B50

### C950



玄铁C950是64位高性能多核处理器，采用超标量、乱序执行、8译码宽度微架构。兼容RISC-V RVA23 Profile，同时支持Vector Crypto、Zacas、Zama16b、Smmmtt、CoVE、RAS、AIA以及Zalasr等其他扩展。C950采用了先进的微结构技术以实现高性能，包括基于TAGE的分支预测算法、Private L2 Cache、可调节的数据预取机制等。C950 SPECint2006性能分数超过22/GHz。

达摩院玄铁

14B50

### C930

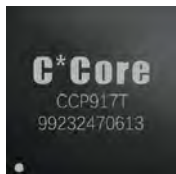


玄铁C930是64位高性能多核处理器，采用超标量、乱序执行、6译码宽度微架构。兼容RISC-V RVA23 Profile，同时支持Vector Crypto、Zacas、Zama16b、Smmmtt、CoVE、RAS、AIA以及Zalasr等其他扩展。C930采用了先进的微结构技术以实现高性能，包括基于TAGE的分支预测算法、Private L2 Cache、可调节的数据预取机制等。C930 SPECint2006性能分数超过17/GHz。

苏州国芯科技股份有限公司

14B50

### 超高性能云安全芯片CCP917T



CCP917T 基于国芯科技自主RISC-V架构的CRV7 多核处理器设计，主频1.4GHz，集成NPU，是面向云场景的高性能安全芯片，内嵌国密/国际算法硬加速引擎并支持硬件虚拟化，适用于高性能计算、高速数据处理和 AI 推理等复杂场景。它具备超高性能、高安全性、高可靠性和高扩展性，参数优异，可满足对安全、性能及稳定性要求高的场合，应用于云计算、数据中心、金融和通信等领域。

厦门算能科技股份有限公司

14B50

### RISC-V计算服务器SRA3-40



SRA3-40是一款面向高性能计算的RISC-V 通用服务器，搭载算丰第二代RISC-V处理器SG2044，采用开源指令集，无授权限制，兼容国产操作系统，实现服务器全栈国产化。多核并发，算力强劲，算丰TPU异构融合，支持混合精度计算，适用于科学计算、可信计算、智能计算、视频转码、深度学习与大语言模型推理等应用场景。



## 计算与通信

[领取参观证件](#)

深圳市思凯迈科技有限公司

14A20

### 华为电源 GDQ100S12B-4P



GDQ100S12B-4P是新一代隔离DC-DC电源模块，采用非标准1/4砖结构，具有高效率、高功率密度、低输出纹波、低噪声等特点。输入电压范围：36V~72V，输出额定电压12V，最大输出电流100A。

深圳市思凯迈科技有限公司

14A20

### 华为电源R4850G6



R4850G6是一款高效率、高功率密度的数字化整流模块，实现宽范围电压输入，53.5V/57V DC默认输出。具有软启动功能、完善的保护功能、低噪音、可并联使用等优点。通过电源监控实现整流模块状态、负载的实时监测和输出电压调节功能。

合肥芯动力科技有限公司

14B72

### AzureBlade MC2A智能加速卡



基于自研 RPP 架构的 AzureBlade MC2A 智能加速卡，面向中高算力 AI 场景打造。产品采用 12 核全互联架构构建片内算力集群，多核高速互联彻底消除片内通信瓶颈，多卡并行效率大幅领先传统 PCIe 互联方案；聚合算力可单机承载百路实时视频分析、中大型大语言模型推理等高并发负载，兼顾高吞吐密度与部署灵活性，可广泛适配服务器、智慧城市、工业视觉、边缘智算中心等规模化部署场景。

象帝先计算技术(重庆)有限公司

14B62

### XDXR2900E工作站显卡

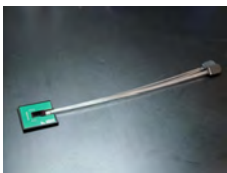


XDX R2900E显卡是象帝先公司面向图形工作站核心应用领域开发的一款高性能专业显卡。其搭载全新一代“天钧三号”GPU 芯片，并配备16GB高速GDDR6显存，可以轻松应对各类大型3D建模、仿真场景对渲染能力及显存空间的需求。XDX R2900E 显卡具有强大的视频编解码能力，能够流畅处理各类主流格式4K超高清视频，为数字孪生、地理信息、工业设计、影视制作、安防监控等专业场景提供高效、稳定的硬件支撑。

上海澜昆微电子科技有限公司

14B62

### OCI光引擎产品

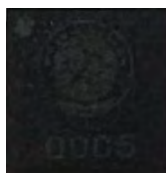


4T-8TbpsOCI光引擎产品，采用全自主光+电融合设计，单波32~64G，光芯片大规模集成MRM调制器。

合肥云联半导体有限公司

14B62

### 光通讯安全加密芯片



光通讯加密安全芯片：具备自主可控的加密算法内核，支持国密算法全适配，可实现光传输链路数据加密、身份认证、防篡改、防窃听全流程安全防护，适配5G、F5G、数据中心高速光传输场景。芯片集成加密、解码、校验多功能模块，无需外挂加密器件，集成度高、传输延迟低，可适配400G/800G高速光模块传输需求，填补国内中高端光通讯安全芯片国产化短板，摆脱海外芯片垄断依赖。

深圳市安信达存储技术有限公司

14B62

### 嵌入式芯片模组芯片



AXD的嵌入式存储芯片模组是为解决空间限制与数据保护难题的理想方案。其核心优势在于使用一体化封装的芯片，使用到mSATA M.2-SATA M.2-NVME等紧凑型PCB，节省大量的PCB空间，可以利用空间部署AXD先进的PLCDF等断电保护技术电路和组电容阵列，实现高效掉电保护。即便在突发电源事件中，也能即时供电于SSD，确保数据安全无忧。

澜起科技股份有限公司

14B52

### CXL® 内存扩展控制器 (MXC)



CXL®内存扩展控制器 (MXC)是一款符合CXL Type 3 规范的DRAM内存控制器芯片，可为CPU及基于CXL协议的设备提供高带宽、低延迟的高速互连解决方案。该芯片支持跨主机的内存池化与共享，简化软件栈，助力数据中心降低总体拥有成本 (TCO)。MXC芯片适用于内存扩展卡 (AIC)、背板或EDSFF内存模组，可大幅扩展内存容量和提升带宽，以满足数据密集型应用日益增长的需求。

20



## 车规级芯片

[领取参观证件](#)

深圳市中兴微电子技术有限公司

14A55

### 车规级高性能中央计算平台 SoC芯片—“撼域”M1



M1 芯片是撼域系列第一颗面向新一代 E/E 架构的车规级高性能中央计算平台 SoC 芯片，具备大算力、高带宽、大存储、高安全的多域融合高速连接能力，可从容应对未来域集中架构的各种应用场景。

深圳市中兴微电子技术有限公司

14A55

### 车规级舱驾控一体中央计 算SOC芯片-“览岳”A1



A1芯片支持数字座舱、智能驾驶、智能车控、安全及车联网五大核心领域深度整合的“高算力、大带宽、低成本”可靠基础算力平台，满足智能网联汽车EEA向中央计算演进。

比亚迪半导体股份有限公司

16C65

### 超级沟槽栅车规IGBT 芯片——IGBT8.0



全球领先超大功率密度车规IGBT芯片，全新一代自主研发IGBT芯片，采用超精细沟槽技术，逼近物理加工极限，能效大幅提升。功率密度全球领先，定义电驱IGBT芯片效能和轻量化设计新标准。  
超深亚微米沟槽栅；  
超高电流密度；  
优异的开关特性，关断损耗达行业最优水平；  
超大单芯设计，单芯片电流规格最高可达700A；  
能效和续航全面提升；超高功率密度；  
驱动功率提升30%，零百公里加速时间更短。

比亚迪半导体股份有限公司

16C65

### 车规级BMS模拟前端芯片

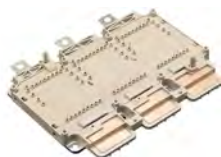


BMS AFE  
· 国产厂商产品系列最多，BMS AFE国产厂商装车量第一；  
· 全球最高集成度的车用BMS ASIC完整解决方案，护航全球最快闪充二代刀片电池；  
· 工作电压：16V~115V  
· 18通道  
· 精度：±1mv@typical  
· 300mA内置均衡  
· 1Mbps菊花链通信

比亚迪半导体股份有限公司

16C65

### V-350



规格：  
IGBT：750V 400A~950A  
1200V 500A~700A  
SiC：1200V 840A~1040A 2.8mΩ~4.2mΩ  
亮点：  
IGBT：采用自主研发高性能的IGBT芯片和FRD芯片；其中750V增强型IGBT，支持520V应用；功率覆盖段广。  
SiC：内含自主研发的SiC芯片，采用双面银烧结工艺，具备车规级高可靠性；采用叠层激光焊接结构，具有低损和极低寄生电感的特性，有效提高电控效率和过流能力。

深圳市安信达存储技术有限公司

14B62

### 嵌入式存储芯片



AXD PCIE NVME BGA SSD嵌入式存储芯片，具有支持 NVMe 1.3 及 PCIe 3.0 协议，PCIe 3.0 X4接口速率并且向下兼容X2 X1。可为嵌入式计算设备提供非易失性存储解决方案，目前已和龙芯，飞腾以及申威平台等国产平台适配认证。

苏州国芯科技股份有限公司

14B50

### 高性能汽车电子AI MCU芯片CCRC4XXX



基于自主RISC-V 架构CRV6多核处理器设计的抗量子高性能车规AI MCU，采用22nm RRAM工艺，主频最高500MHz，集成0.3TOPS NPU与硬件安全模组HSM，支持抗量子与国密/国际算法硬加速。符合 AEC-Q100 车规与 ISO 26262 ASIL-D 最高功能安全等级，具备超高算力、抗量子安全、高可靠与高扩展性，可满足智能驾驶、中央域控、跨域融合、底盘/动力域等高安全与高算力需求。

武汉新芯集成电路股份有限公司

15D42

### 新芯股份 SPI NOR Flash芯片



新芯股份SPI NOR Flash芯片，采用浮栅型（Floating Gate）工艺结构，工作电压涵盖1.2~3.3V，支持低功耗宽电压工作，丰富且小巧的封装规格，助力计算机、消费电子、汽车电子、工业控制、物联网等应用市场发展。



## 消费电子/工控类芯片及器件

领取参观证件

北京君正集成电路股份有限公司

14B65

CW080



CW080专为AI眼镜、智能穿戴、微型视觉终端打造，采用 QFN90 7mm\*11mm超小封装；内置1Tops@INT8 NPU，支持4K@30fps H.265编码、12MP 拍照、双摄拼接、端侧EIS 防抖；内置DDR，休眠功耗约1mW，运行功耗较前代降30%；兼顾高性能与长续航，是穿戴AI视觉的旗舰方案。

北京君正集成电路股份有限公司

14B65

X2600



X2600 是一款面向商业和工业应用的多核异构跨界微处理器。它以 XBurst2 (MIPS)、Victory0 (RISC-V) 和 XBurst0 的组合作为计算核心。除了常见于应用处理器中的强大计算能力外，X2600 同时还兼具低功耗的实时控制能力。

合肥芯动力科技有限公司

14B72

AE7103



AE7103 采用 14nm 工艺、19x19mm FCBGA封装，芯片基于自研可重构并行处理器（RPP）架构设计，可全面覆盖云、边、端全场景AI部署需求，原生兼容DeepSeek、Qwen、Llama等主流大模型，支持PyTorch、TensorFlow等主流AI框架及ONNX模型格式；同时深度适配CUDA开发生态与OpenRT推理框架，开发者可直接复用现有代码资产与开发经验，实现模型一键平滑迁移，有效降低部署成本，大幅缩短项目落地周期。

珠海泰芯半导体有限公司

14B62

AI大模型音视频SOC



2.4GHz Wi-Fi + BLE双模，内置MJPEG编解码器，Audio+Video同步处理，玄铁E803内核，主频240MHz。TXW81X已接入DeepSeek、豆包、通义千问、百度文心、扣子、讯飞聆思、酷旗、探鸽八大主流大模型平台，方案商拿到SDK即可开发产品。应用方向：AI玩具、陪伴机器人、AI儿童相机、英语听力宝、儿童音视频对讲机。

苏州国芯科技股份有限公司

14B50

端侧AI芯片CCR4001S



CCR4001S 芯片基于国芯科技自研 RISC-V 内核 CRV4H 设计，主频可达 230MHz，集成算力达 0.3 TOPS@INT8 的神经网络处理单元（NPU），可高效实现端侧 AI 任务加速。芯片兼具高效能、低功耗与易用性优势，配套完备工具链及生态支撑，能够助力客户快速搭建端侧智能应用闭环。目前已在智能家电、婴儿看护、工业检测、光伏拉弧检测以及车载、电机控制等多个场景实现规模化落地与稳定验证。

苏州国芯科技股份有限公司

14B50

高性能边缘AI SoC芯片  
CCR7002

CCR7002采用多芯片封装技术，集成高性能SoC芯片子系统与AI芯片子系统，实现了高性能SoC子系统与低功耗AI子系统的有效结合。其中，高性能SoC芯片子系统搭载四核64位高性能RISC-V处理器，工作频率最高可达1.5 GHz；AI芯片子系统搭载32位低功耗RISC-V处理器，集成NPU神经网络处理单元，提供0.3TOPS算力支持。该芯片配备丰富的外部接口及多个高速接口，可面向工业控制、能量控制、楼宇控制、新能源、智慧交通等领域应用。

成都华微电子科技股份有限公司

14B55

CSD01001PQFN28I



主要特性：使用高性能RISC-V的32位内核，工作电压为1.8V~3.6V，内嵌64KB Flash、8KB SRAM；片内时钟最高输出20MHz。支持的低功耗模式包括休眠模式、待机模式，支持JTAG&JTAG调试接口。应用场景：可广泛用于低功耗领域，包括便携式设备、电池供电物联网节点、工业监测节点、环境感知节点。

成都华微电子科技股份有限公司

14B55

CSD7Z020CLG484I



主要特性：电源电压 核心电压1v、IO电源电压1.2-3.3v；千万系统门；最高系统频率800M；内嵌BRAM容量4.9Mbits；PL 宽范围用户IO数200个；PS 通用IO数128；PL DDR3接口速率800Mbps；PS DDR3接口速率1066Mbps；全流程自主开发工具。应用场景：可广泛用于电力行业、轨道交通、工业自动化、有线和无线通信、医疗内窥镜设备等领域。



## 消费电子/工控类芯片及器件

[领取参观证件](#)

合肥芯动力科技有限公司

14B72

## AE7100E



AE7100E芯片基于自研可重构并行处理器（RPP）架构设计，采用14nm工艺、17×17mm FonOut FCCSP 封装，可全面覆盖云、边、端全场景AI部署需求，原生兼容DeepSeek、Qwen、Llama等主流大模型，支持PyTorch、TensorFlow等主流AI框架及ONNX模型格式；同时深度适配CUDA开发生态与OpenRT推理框架，开发者可直接复用现有代码资产与开发经验，实现模型一键平滑迁移，有效降低部署成本，大幅缩短项目落地周期。

京微齐力(北京)科技股份有限公司

14C70

## HME-PV65



新一代异构可编程计算芯片、通用FPGA芯片、专用EDA软件及相关解决方案。

珠海泰芯半导体有限公司

14B62

## Wi-Fi HaLow™ SOC



Wi-Fi HaLow™基于IEEE 802.11ah协议，运行在750MHz-930MHz Sub-1GHz频段。空旷环境传输距离1.5公里，穿透4层楼板或9堵实墙，待机功耗200μA，单芯片支持8191个设备并发接入，可同时传输8路1080P视频。应用方向：具身机器人、割草/扫雪机器人、无线监控套装、Baby monitor、智能门铃。

东莞市达昌智科电子有限公司

14B76

## FPGA芯片



中科亿海微品牌高自主高可靠FPGA芯片，采用国产先进工艺，软硬件一体正向设计，丰富的逻辑资源，实现从软硬件设计、流片、封装、测试全流程自主可控。具有高性能、高可靠、低成本、小尺寸、低功耗等特点。

智芯科（合肥）芯片设计有限公司

14B62

## 超低功耗端侧多模态推理芯片



1、离线语音AI芯片AT680 针对超低功耗语音识别场景为穿戴产品实现极致降低功耗。应用：AI眼镜、AI耳机、AI手表、离线智能语音开关，需要低功耗语音的AI硬件均可应用。2、AI芯片AT690 首个离线端侧全屋控制NLP芯片，极致能效比。应用：全屋智能控制、智能机器人、AI对讲机、AR、VR、AI硬件。

爱特微（张家港）半导体技术有限公司

16C73

## TGAN20N135FDL2

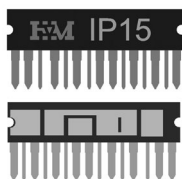


1350V 场截止沟槽型 IGBT,内置续流二极管。器件集射极耐压 1350V,栅极耐压 ±25V; 25°C连续电流 40A, 100°C为 20A, 脉冲峰值电流 100A, 工作结温 -55°C~150°C。其导通损耗低、开关速度快,具备正温度系数,支持多管并联。IGBT 结壳热阻 0.56°C/W, 散热性能良好。常温下饱和压降典型 1.8V, 开关时序短、整体损耗可控。

芜湖华沅微电子有限公司

16C98

## IP15一体化无刷模组



IP15一体化无刷模组，已内部按无刷电机方式连接；一次插件，替代传统6个分离器件，安装方便；6颗芯片按MAP取样，一致性更佳；体积小，效率高，单颗模组最高支持3000W功率电机。

深圳市思凯迈科技有限公司

14A20

## 华为电源GDC75S12-PD



GDC75S12-PD是新一代隔离DC-DC电源模块，采用非标准1/4砖，体积：64.8\*42.0\*9.5mm，具有高效率、高功率密度、低输出纹波、低噪声等特点。输入电压范围：34V~72V（正常起机电压需大于36V），输出额定电压12V，输出额定功率900W。



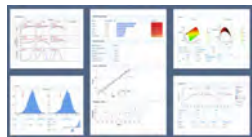
## EDA&amp;IP

领取参观证件

杭州广立微电子股份有限公司

14A65

## DE-G 专业、灵活、高效的通用型统计分析平台



DataExp-General (简称DE-G) 是广立自主研发的智能数据决策引擎,以"更快、更深、更准的数据洞察"为核心,重构数据认知维度。作为一款专业、灵活、高效的通用型统计分析平台,DE-G深度融合可视化探索、预测建模、实验设计、六西格玛质量管理等数据分析技术,通过智能分析驱动决策,为半导体制造、化工与材料、生物医药、高端装备制造、金融科技等行业提供数据价值挖掘的终极解决方案。

杭州广立微电子股份有限公司

14A65

## QuanTest-YAD良率感知的大数据诊断分析平台



QuanTest-YAD是一款综合性的DFT诊断分析工具,能够独立解析各类主流诊断报告,也可以与YMS集成,串联芯片设计、制造和测试环节的数据,从而深入挖掘良率失效的根本原因。借助人性化的全景交互和先进AI算法,YAD能够帮助快速定位芯片从设计到制造端的根因缺陷、加速诊断分析、提升产品良率。

深圳鸿芯微纳技术有限公司

14B56

## 逻辑综合工具RocSyn®



RocSyn是一款全功能版图驱动的逻辑综合工具,实现从硬件描述语言(HDL)输入到门级网表输出的芯片自动化设计流程,涵盖HDL编译、高层次优化、低功耗综合和优化(包括UPF支持)、工艺映射、时序驱动优化和版图驱动优化的全部技术。该工具支持业界标准的输入和输出数据格式,内含多层次、多方位的高性能引擎,提供多样化的报告输出,并且拥有友好的用户界面和灵活脚本支持。

深圳鸿芯微纳技术有限公司

14B56

## 布局布线工具Fantaisie®



Fantaisie是一款全功能数字芯片布局布线工具,提供从门级网表输入至GDS II输出的自动化设计流程,涵盖版图、电源网络设计、布局优化、时钟树综合、后时钟树优化、布线优化及顶层集成。其模块级布局布线内嵌强大分析引擎,为各环节提供实现与优化;支持业界标准输入输出格式、自上而下层次化顶层设计,并提供界面与脚本支持。

隼瞻科技(广州)有限公司

14B50

## DSA处理器敏捷开发平台 ArchiStudio

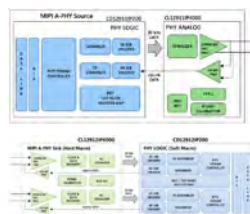


ArchiStudio是一款面向DSA设计的EDA处理器敏捷开发平台,基于算法芯片化,场景架构化的理念,为以RISC-V定制处理器为核心的SoC设计方法学带来了革命级的改变。在ArchiStudio的基础上,设计人员得以摆脱了RTL级别的繁复开发工作,更专注于架构和指令集的设计;其一键式的SDK生成引擎更是大量减少了软件工具链开发的工作量,显著缩减了处理器开发的人力成本。

Curious Tek Pte, Ltd.

14B79

## MIPI A-PHY



CL12911IP4000 源端和 CL12912IP4000 接收端是面向汽车及 ADAS 应用的 MIPI A-PHY v1.1 IP。两者均支持 Gear-2/Profile-1, 最高速率达 4 Gbps, 并配备 20 位并行接口、25 MHz 输入时钟、最高 200 MHz 输出时钟,以及最长 15 米的同轴电缆或屏蔽双绞线链路。源端支持 TX 时钟生成,接收端提供时钟与数据恢复及眼宽监测。

广州玻色永生科技有限公司

14C87

## 五大专利包



拓扑材料与先进制造专利包;量子计算与光电子器件专利包;投影调控与并行计算专利包;核聚变与重力控制专利包;探测与成像系统专利包。

无锡市肯恩科技有限公司

14C08

## AI智能监控CMS系统



AI智能监控CMS系统是一套面向工业温控设备的智能化可视化监控平台,适用于集成电路、半导体等温度过程控制要求严苛的制造场景。产品支持私有化部署、数据安全可控,帮助企业看得到现状、查得到根因、防得住故障,全面提升设备运行稳定性与运维管理效率。



## 半导体核心零部件

[领取参观证件](#)**沈阳新松半导体设备有限公司****15A40**

### 半导体晶圆传输专用设备



新松真空直驱机械手产品拥有领先的重复定位精度、高效的传输节拍、灵敏的碰撞保护以及AWC动态纠偏等功能,可根据用户需求定制手臂长度和手指形式,胜任不同尺寸规格的晶圆搬运。新松真空直驱机械手已通过SEMI权威认证,广泛应用于PVD、CVD、刻蚀等集成电路整机装备中,彻底打破国外技术垄断,核心技术完全自主可控。

**安徽万瑞冷电科技有限公司****15B35**

### 低温真空泵



低温真空泵,简称冷泵/低温泵,通过G-M型低温制冷机产生10K(-263℃)深低温,利用低温冷凝,使气体分子在冷凝表面凝结成固体或液体,利用吸附剂对气体进行吸附,从而达到抽取气体获得真空,已广泛应用于集成电路制造工艺与设备中。

**上银科技(中国)有限公司****15A60**

### 晶圆装卸机Load Port



HIWIN晶圆装卸机Load Port HLP系列可共享8寸与12寸产品加载载出,能直接对应8寸与12寸FOUP/FOSB,亦可选配6寸8寸open cassette的载具对接平台(Adapter)。HFLP系列可满足12寸FrameFOUP需求。产品洁净度等级为Class1,应用于半导体各制程设备,如:微影、蚀刻、CVD、PVD、清洗、检测、封装等。

**昆山新莱洁净应用材料股份有限公司****15A70**

### ALD阀门(UHP)原子层沉积高速控制阀



- 高速驱动,超高循环寿命
- Cv 范围为0.27 ~ 0.62
- 采用耐热执行器,使用温度高达 392°F (200°C)
- 可选购电子或光学执行器位置传感
- 采用 316L VIM-VAR 不锈钢本体,适用于超高纯应用
- 模块化表面安装,管道对接焊接和 VC (VCR) 端口连接。

**深圳市灿锐科技有限公司****15D45**

### 高倍线扫、超大面阵专用镜头



具备高分辨率、高亮度以及优异的成像质量一致性,最大像方视野 L62mm、φ67mm、L82mm;渐晕可几乎完全消除,专门的宽带多层镀膜技术,保证镜头在400-1100nm波段都具有良好的透射率;调试安装便捷,支持0.03-5.9X之间倍率选择与调节。

**嘉善司倍克泵业有限公司****15A80**

### 磁力泵 CY-4281 MK



SPECK 磁力泵 全规格都是不锈钢系列 无机封,全部都是磁力驱动泵 操作温度:-120~+400℃ 搭载高效电机,全系列产品已达 IE4(国标 GB2,GB1 依照客户要求) 有多种附加选择,依据不同工况来交叉搭配 产品具有高可靠度,高精度,长使用寿命,并可依据实际的使用工况来定义相应的泵和电机的工作条件,以不同的材料,不同的附加工艺来实时应对不同工况的流体需求。

**东莞市冠业传动科技有限公司****14D50**

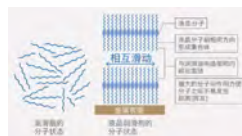
### 高速三轴直线电机模组



高速三轴直线电机模组,动子采用碳纤维做骨架,碳纤维的优势是重量刚性强,相同的厚度刚性是铝的10倍,密度不到铝的三分之二。动子和定子带气冷,在高速和高加速度运行当中很好的散热效果。动子很轻一个动子重量大约在200多克,应用最高加速度可以跑到18G。广泛应用于半导体IC固晶。

**深圳四达全精密机械有限公司****15B01**

### 高真空、高洁净环境下的轴承、导轨、丝杆、工作台均适用的特殊润滑介质



液晶润滑通过形成分子集合体,不仅金属表面粘附性有所提高,而且还能更大程度地抑制挥发。用于液晶润滑系列产品的液晶润滑剂是一种不仅能在滚动接触状态时,高表面压力下发挥优异润滑性能,而且还成功实现了强大功能的轴承用液晶润滑剂。



## 半导体核心零部件

[领取参观证件](#)

星奇（上海）半导体有限公司

15B25

### 高速响应ALD阀



超高纯快速响应流控部件是专为原子层沉积工艺研发的特种阀门，主要应用于半导体制程工艺中CVD、ETCH、ALD、ALE等对真空度和气体纯度要求极高的领域。精准控制前驱体气体的脉冲式输送，实现原子级别的薄膜沉积；具备超高密封性，可维持系统高真空环境，避免气体交叉污染；能快速反馈开关信号，满足原子层沉积工艺对时序控制的严苛要求。

成都中科四点零科技有限公司

15E12

### VF系列射频半导体自动测试机



产品集成自研高性能PXI模块化仪：矢量网络分析仪、矢量信号收发仪、精密源表及数字控制接口，以及可灵活扩展的开关阵与RF Module，搭载自研软件框架，能够一站式完成从滤波器、开关、FEM及PAMiD/PAMiF等复杂模组的S参数、开关时间、EVM、ACLR、谐波、静态功耗等全部射频与直流指标测试，支持标准化STDF数据输出与MES对接，满足射频前端从高效量产到工程验证的多样化需求。

东莞市上可优机械五金有限公司

15E03

### mitutoyo三丰影像测量仪



自动对焦功能，0.35u超高精度，实现多种产品多种需求测量。

有氟密管阀集团有限公司

15C115

### 衬氟蝶阀



衬氟蝶阀是针对强腐蚀性流体工况开发的专用工业阀门。阀体以碳钢或球墨铸铁为结构基体，所有与介质接触的内壁、阀板、阀杆等部位均全衬覆聚四氟乙烯（PTFE/F4）、聚全氟乙丙烯（FEP/F46）、可熔性聚四氟乙烯（PFA）等氟塑料，彻底隔绝腐蚀介质与金属基体的接触，具备优异的耐酸碱、耐强氧化、耐有机溶剂腐蚀性能。

百士吉泵业（天津）有限公司

14B37

### 阿迈得E2.0气动隔膜泵



阿迈得®E2.0系列气动隔膜泵的开发基于百士吉公司多年技术积累与市场反馈，通过持续不断的创新设计与产品迭代优化，实现卓越性能。其独特特点包括中心块结构、优化壁厚、法兰连接、创新环紧固结构等，全面满足客户在安全性、耐用性和高纯化学品传输方面的严格需求。E2.0系列适配市场主流应用场景，并提供多种可选配置。

深圳市高川自动化技术有限公司

14A80

### 插卡型运动控制器



GCS-PCIE系列多轴运动控制卡是一款集运动控制技术和网络通讯技术于一体的高性能插卡式运动控制卡。控制卡可以控制1-16轴脉冲/模拟量伺服电机，同时支持EtherCAT IO模块扩展，为用户提供了多轴数、多IO点数的脉冲/模拟量/总线控制解决方案。

镇江市德利克真空设备科技有限公司

15B93

### 隔膜阀



高纯介质专用隔膜阀，无管路死角，兼顾真空与腐蚀性气体输送控制。

清能德创电气技术(北京)有限公司

15A28

### CoolDrive D5全功能型直驱伺服驱动



CoolDrive D5系列伺服驱动是清能德创最新研制的一款全功能型直驱伺服驱动产品。该产品采用全新硬件架构和直驱专用伺服算法。配合直线电机或DD马达，可实现更高精度，更快响应，运行更加平稳可靠，是直驱运动控制方案的绝佳选择。



## 半导体核心零部件

[领取参观证件](#)

兆默半导体设备（上海）有限公司

15B20

离子注入PTM上腔体、下腔体



PTM上腔体是半导体离子注入机的核心工艺腔体部件，与下腔体组合形成高真空注入靶室，主要用于晶圆离子掺杂工艺，为束流注入、电荷中和、温控洁净制程提供稳定密闭环境，广泛适配国产及进口8/12寸量产离子注入设备，是保障注入精度与晶圆良率的关键备件。

阿米精控科技（山东）有限公司

14A85

五轴/六轴重载荷压电平台



重载五自由度压电平台基于微纳柔性机构和压电执行器实现超高分辨力纳米运动，通过高性能纳米伺服系统实现闭环控制，具有亚纳米级运动分辨率、纳米级运动精度和高速、高动态轨迹扫描功能。

上海隐冠半导体技术股份有限公司

15A16

复合式多轴精密位移系统



■ X、Y1/Y2、Z、T五轴 ■ 机械导轨与气浮导轨的复合应用 ■ 360°无限制旋转运动，无管路缠绕，支持12'、8'、6'多种规格晶圆吸附 ■ 行程：320 mm (X轴)；550 mm (Y1/Y2)；10 mm (Z轴，可定制) ■ 双向重复精度：±0.4μm (X、Y轴)；±0.3μm/2 mm & ±1μm over range (Z轴) ±2 arcsec (T轴) ■ 垂向磁悬浮重力补偿 ■ 最大支持转速150rpm。

深圳气立可气动设备有限公司

16A60

超声波流量检测器



以「外夹即测」颠覆传统安装，免裁管、免停线，实现零污染、零压损，快速导入产线。此次升级新增大口径规格(ø52mm至ø127mm)，量测范围更广，从小口径精密制程到大流量管線皆能精準掌握。±1%高精度，搭配RS-485與警報功能，助力智慧監控。無論是半導體的超純水、生技醫療的藥液，還是食品飲料、化工與水處理，FN-V都能提供高效、可靠、低維護的流體解決方案。

埃迈诺冠气动器材（上海）有限公司

15B85

VPPC比例调压阀(电子闭环控制)



IMI Norgren VPPC02/VPPC08系列比例调压阀搭载电子闭环控制，支持0-10V、4-20mA两种控制信号精准调压，输出量程覆盖0-2bar、0-8bar，控制精度±0.1%、重复精度优于±0.2%，调压性能出色。该阀可实时监测并稳定调节气浮台气垫压力，实现姿态平衡与载荷补偿，显著提升平台平稳性和定位精度。

奕瑞电子科技集团股份有限公司

16B82

Libra09UINJ-01/02 90kV 8W微焦点X射线源



Libra09UINJ是一款奕瑞自主研发设计的一体式微焦点射线源。最大电压为90kV，图像分辨率为5~10μm，主要适用于电子行业检测，如四平面封装、3C电池检测、BGA封装、LED和PCB检测等。产品特点一体化设计，易于拆卸安装 5~10μm图像分辨率和9.5mm FOD，适用于高分辨率、高放大倍数的影像系统 支持离线/在线使用，适合长时间稳定曝光 行业通用RS-232C通讯协议，便于集成。

深圳市克洛诺斯科技有限公司

14D55

半导体制造先进封装核心运控平台木星



用途：先进固晶制程(倒晶封装、扇出、混合键合、2.5D/3D封装)以及Mini LED固晶、键合点胶 性能特点 1、在10K UPH吞吐量情况下达到+350nm的局部贴片精度(同部找正运动) 2、在2K UPH吞吐量情况下达到+200nm的局部贴片精度(同部找正运动) 3、±1um全局贴片精度(盲动) 4、<10分钟的热瞬态(从冷态到热态工作) 5、典型倒晶固晶应用的吞吐量达10KUPH 6、混合键合应用的吞吐量达2K UPH 7、Mini LED固晶的吞吐量达180K UPH。

深圳银光机器人技术有限公司

14A39

微型电缸（微型电动执行器）



银光Smart-Z3控制一体型智能电缸集传动本体，伺服，驱动和控制功能于一体。紧凑，控制器小体积，走线简单，具有智能化调试和检测功能。



## 半导体核心零部件

[领取参观证件](#)

沈阳纪维应用技术有限公司

15C01

### GWSP系列无油涡旋真空泵



GWSP系列无油涡旋真空泵由泵头、电机、风扇和支架等构成，泵头包括一个带有双面盘壁的动涡旋盘、两个带有单面盘壁的定涡旋盘、密封条组件、曲轴和轴承等，动涡旋盘与定涡旋盘组成的双侧涡旋盘副是泵的基本抽气结构。拥有100%全无油，维护方便，低振动、低噪音、低能耗等优点，主要应用于分析测试仪器、半导体、材料制备、医疗设备等行业。

江苏科瑞斯机件有限公司

16B95

### 拖链



作为自动化和机械设备传动和防护部件，主要用于线缆、气管的运动防护。

横川机器人（深圳）有限公司

15B87

### 涂胶显影-高速水冷直驱电机



DMFI99-003RE 特性: 1、高转速，最高转速6500-8000rpm2、运转稳定，速度波动 $\leq 5\%$ 3、良好的温升控制，温升 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 。

挪视光学显示技术（上海）有限公司

14A37

### LLS1000先进封装专用数字直接成像曝光头



LLS1000 是 Visitech 最新推出的高端无掩模光刻系统，专为先进封装应用而设计，采用全新的设计平台。该系统可轻松处理1微米Line/Space，并支持多曝光头拼接配置，以实现各种基板尺寸（无论是板级还是晶圆级）的高效率批量生产。该系统基于 Visitech 专有的405nm激光光源，也可根据需求选配375nm激光光源，以满足特定波长要求的应用场景。

深圳市先晋精密科技有限公司

14C115

### 半导体真空传输模组 (VTM)



APT 自主研发的真空晶圆机械手与陶瓷手臂 VTM 模组，是半导体晶圆传输系统的核心部件。产品采用全自主设计架构，可实现真空环境下晶圆的高精度、低发尘、高稳定性传输，重复定位精度高，适配8寸、12寸晶圆工艺需求。陶瓷手臂采用高纯度氧化铝材质，具备优异的耐温、耐磨与低颗粒释放特性，配合自研运动控制算法，可实现多轴联动平滑运动。

上海疆禾科技有限公司

15D72

### DISPAL高性能铝合金材料-用于半导体设备核心零部件



DISPAL高性能铝合金材料因其密度低，刚度高，强度大，散热好，耐磨，机械加工性能好等特点，广泛应用于半导体设备核心零部件（横梁，导轨底座，滑台板，运动底板，高速高频运动部件），光学部件等，大幅提升设备精度及稳定性。

深圳瑞升新材料科技有限公司

15A63

### CMP晶圆研磨carrier



CMP晶圆抛光镀金金刚石载具

深圳二四九五半导体科技有限公司

15C90

### 多晶金刚石热沉片 (标准+定制系列)



将展示标准规格（ $10 \times 10 \text{ mm}$ 、 $15 \times 15 \text{ mm}$ ）及客户定制热沉片实物，热导率1000-2000W/m $\cdot$ K可选，现场演示红外热成像散热对比；可以应用于手机OEM/ODM、GaN/SiC器件厂商、射频模组厂等领域场景



## 半导体核心零部件

[领取参观证件](#)

江苏弘扬石英制品有限公司

15D75

### 7N级合成石英砂



通过化学合成法生产，纯度可达99.99998%以上，可用于生产半导体晶圆拉晶用石英坩埚、半导体先进制程中用到的石英刻蚀原材料等，实现国产替代。

高富高新材料（浙江）有限公司

14D08

### 氮化硅静电吸盘

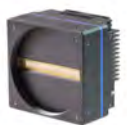


半导体刻蚀、薄膜沉积设备核心载台。以氮化硅做绝缘表层，绝缘耐腐蚀、热膨胀系数与硅晶圆匹配，依靠高压静电牢牢吸附硅片。能实现均匀温控，降低晶圆翘曲、划伤，放电剥离顺畅，适配先进制程高精度加工需求。

深圳市度申科技有限公司

14A45

### DXL16K12CT-H1NF 双光口线阵工业相机



度申科技率先推出的20G双光纤线阵工业相机，传输带宽可达2200Mb/s，支持300米长距抗干扰传输，线缆轻便且供应链自主可控；搭载5μm大像元，创新推出16K机型TDI+分时频闪方案，搭配自研采集卡，低噪低功耗；集成多种ISP算法，具备强大的相机监控功能，适配高端3C、半导体、锂电、印刷等高精度检测场景，为智能制造视觉检测领域提供高性能解决方案。

深圳市明新半导体超硬工具有限公司

14C12

### 金刚石划刀片、金刚石陶瓷减薄轮

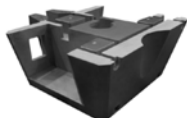


金属划刀片是有金属或者合金粉末与金刚石烧结而成，具有高强度、切割寿命长的优势。金属划刀片的刚性好，可以避免切割面倾斜或者蛇形切割面等不良的切割问题。

山东天马泰山机械集团有限公司

15D39

### 大理石平台构件



大理石平台构件、陶瓷构件、应用于半导体晶圆检测设备、光学设备、PCB加工检测设备、运动平台领域。

水艺赛流SiFLUID

14B32

### 水艺SiFLUID®IMR系列MBR膜产品



水艺SiFLUID®IMR系列MBR膜采用低压大通量PVDF中空纤维复合膜，等间距整齐排布技术，膜箱配备脉冲曝气装置，具有运行通量大、产水水质稳定、抗污染能力强、使用寿命长、能耗低等特点，同时，相比传统MBR膜，气水比最低可达4:1，能耗降低40%以上，可广泛应用于半导体、市政、工业污水等处理领域。

奕瑞电子科技集团股份有限公司

16B82

### Libra09UINJ-01/02 90kV 8W微焦点X射线源



Libra09UINJ是一款奕瑞自主研发设计的一体式微焦点射线源。最大电压为90kV，图像分辨率为5~10μm，主要适用于电子行业检测，如四平面封装、3C电池检测、BGA封装、LED和PCB检测等。产品特点 一体化设计，易于拆卸安装 5~10μm图像分辨率和9.5mm FOD，适用于高分辨率、高放大倍数的影像系统 支持离线/在线使用，适合长时间稳定曝光 行业通用RS-232C通讯协议，便于集成。

上海旭欧轴承有限公司

14A32

### NSK轴承



NSK（日本精工）是全球顶尖轴承制造商，1916年成立，产品覆盖球轴承、滚子轴承、精密轴承、特种轴承四大类，以高精度、长寿命、低摩擦、高可靠性著称，广泛应用于工业、汽车、风电、机床、家电等领域。



## 半导体核心零部件

[领取参观证件](#)

玺奥深冷科技（上海）有限公司

14B28

### 气液分离器



使用不锈钢真空夹套低温调节系统设计用于满足用户所需液氮压力的设备。设备系统设置完毕，液位和压力由控制器自动控制。控制器允许用户设置自己所需的压力和液位。气液分离器的主要功能是在用户使用点(POU)将储罐中较高的液氮饱和压力降低到较低的压力。同时还可消除因热泄漏而在液氮管道中产生的多余气体。

上海万可姆高科技有限公司

16C78

### 真空插板阀



GC/GCQ 系列真空插板阀是在  $1.3 \times 10^{-7} - 10^5 \text{Pa}$  的真空系统中用来开启或隔断气流的气动阀门。以压缩空气为动力，气缸活塞杆推动钢球架运动，撑开阀板关闭，靠弹簧力收拢阀板打开后，再退出的真空阀门。特点：1、结构紧凑、体积小、通导能力大；2、打开时能通过气体、液体、固体、下料和取样等；3、配有直线气缸，装有磁性开关，有指示灯显示开关位置；4、钢球架移动速度快慢不会卡死。

广州岱洲机械设备有限公司

16A82

### 旋转接头



晶盘真空卡盘多通路：MFC系列 单通路：L40系列,LA90系列 在旋转涂布机、抛光机、研磨机等装置上使用。MFC系列：通过采用间隙密封,实现了低发热和低出尘。L40系列：对于主流道,使用的是非金属材料。极力降低金属离子往流体内溶出。LA90系列：采用特种碳密封,即使不进行润滑,也可高速旋转。研磨机CMP 多通路：MFES系列 MFES系列：在接触液部位上使用非金属材料并进行涂覆,以尽量减少金属离子往流体内溶出的结构。

广东摩尔照明有限公司

16E73

### 530滤波黄光LED灯管 20W (半导体/PCB电路/精密光学专用)



黄光LED灯管，稳定波长，完全滤除波长小于530nm的蓝光、绿光、紫外光，专用于对光波长敏感的制程环境中。优势：--3年材料研发和品牌的ODM生产成果--全制程覆盖：530nm方案的宽安全滤波窗口可覆盖从传统制程到3nm/2nm先进EUV制程的全系列光刻工艺，实现产线照明系统的标准化设计，降低不同制程产线的照明技术适配成本。

浙江朝晖过滤技术股份有限公司

15D82

### 袋式玻纤过滤器



产品可应用于商业、数据中心及工业通风空调系统的预过滤，可大量过滤粗颗粒物，保证通风系统的洁净度，改善空气质量，延长后端过滤器使用周期，减少更换频率，降低生命周期成本。

上海丝亚检测仪器有限公司

15B99

### 热式气体质量流量计



精准计量大宗气体流量

欧士机（上海）精密工具有限公司

16B85

### 小径硬质合金钻头 AD·ADO-MICRO



小径孔加工的主要问题根源在于排屑的不稳定性。AD-MICRO通过专为小孔加工优化的切削刃式样和槽型，即使在外部供油下也能形成稳定的切屑形态，实现小径孔的连续加工。而内冷油孔ADO-MICRO，凭借卓越的排屑槽结构与油孔的双重优势，使小径深孔加工“稳定性”且“高效率”。即使是深孔也能进行无阶梯式加工，与阶梯加工相比，加工效率可提升约9倍。

厦门麦达智能科技有限公司

15A25

### PCD钻头



采用高品质聚晶金刚石材质，兼具超高硬度与耐磨性，切削性能稳定，能有效应对铝基碳化硅、陶瓷等脆硬材料加工难题，大幅延长刀具寿命，提升加工效率与表面光洁度，广泛应用于汽车、航空航天、电子等领域。



## 洁净&环境处理

领取参观证件

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

15D32

### 半导体及泛半导体洁净室整体解决方案

芯片制造 先进封装 半导体材料/硅片功率器件光电器件半导体设备 PCB线路板



致和半导体设备(江苏)有限公司

16C74

### Plasma-Wet Local Scrubber

通过高温等离子电弧裂解燃烧水洗模式净化有毒有害气体,用于处理PFCs、硅化合物、水溶性气体和有毒气体等。



江苏宇佳智能装备有限公司

15E45

### 智能精密过滤设备

产品亮点: 1.弯道环流三相分离2.水质频谱分析仪3.自动配比与添加4.微生物管理



江阴市亚泰净化设备技术有限公司

15B65

### 钢制洁净门

钢制门门框、门板均采用连体制作方式,表面为静电喷涂处理,产品无拼缝、无焊点、无死角,整体平整光滑,易清洗,不积尘;此门三面采用高级橡塑。密封条,底部选用自动升降扫地条,气密性强,有效地保证室内的净化效果;观察窗采用双层钢化玻璃,四周镶两公分印花黑边(白边),玻璃与门板表面齐平,密封、牢固,美观漂亮。



昆山市汎启机械有限公司

14B96

### FQMO-12s

产品适用范围:半导体、表面易氧化材质(铝、铜、IC)制程烘烤。特点:内、中筒材质采用 SUS304# 无磁性镜面不锈钢,外箱采用 SS41#中碳钢经磷酸皮膜处理 后两层防锈涂装烤漆,可防止微尘。全周氩焊,耐高温迫紧, SUS304#不锈钢电热产生器,防机台本身产生 PARTICLE;充氮气 N2,避免产品高。温氧化采用电磁门锁,密封性好。



CSE CO. Ltd

16C103

### Chiller Pump WNA-0622SKA & WNA-0628SKA

Chiller Pump / Heat Media Circulation Pump Designed for Industrial Chillers and Heat Exchangers in Semiconductor Applications providing reliable circulation of heat transfer fluids with high efficiency, stable performance, and long service life.



中源绿净技术(深圳)有限公司

16C112

### 数字洁净室环境监测系统

适配半导体晶圆制造、芯片封测洁净车间,搭载自研高精度传感器,24 小时实时采集温湿度、压差、尘埃粒子、微生物浓度等核心洁净参数。配套自研数字化物联网平台,自动完成数据采集、存储、分析,支持超标联动报警、全周期数据溯源、车间分区可视化看板。



理纯(上海)洁净技术有限公司

15C150

### 全自动气体供应设备

用于可燃性、易燃易爆、毒腐性等特种气体系统的封闭式气体放置与气体输送设备例如: SiH4、BCl3、NH3等 1、可适配5-50L钢瓶、集装格、T/Y瓶、杜瓦罐、鱼雷车/ISO槽车等气源 2、全自动控制,稳定输送压力和流量 3、换瓶时自动吹扫保压,保障人员安全 4、根据气体性质设置钢瓶加热、盘面加热 5、支持本地查询和远程监控。





## 洁净&环境处理

[领取参观证件](#)

恒超源洗净科技(深圳)有限公司

16B116

### 碳氢真空清洗生产线



技术参数: 清洗液:碳氢水素 型号:可根据产品特性及产能定制, 3槽&5槽&7槽&9槽&10槽等, 尺寸定制制作周期:50-70天 运用范围: 军工&新能源&航天航空&通讯电子&汽车零部件&卫浴零配件&机械工程&半导体零配件&五金工具等各个领域。

SGS通标标准技术服务有限公司

14C111

### SGS洁净间微污染分析服务



UPW 超纯水 / 电子级水 / DI 水 高规格实验室用水 化学药剂 AMC 气相分子污染物 ISO 8673 压缩空气 CDA/XCDA 制程尾气 (Local Scrubber) Bulk Gas, Special Gas 洁净室 ISO Class 等级验证。

深圳市中建南方环境股份有限公司

15A30

### FFU风机过滤单元



中建南方FFU在传统FFU基础上融合物联网、传感器及智能算法的空气净化设备, 核心功能是通过风机驱动空气流经高效过滤器, 去除空气中的颗粒污染物, 同时具备智能调控、远程管理、状态监测等特性, 为特定场景提供稳定、可控的高洁净环境, 广泛应用于对空气质量要求严苛的领域。

江苏言信环境科技有限公司

15B65

### 净化板



该产品为净化岩棉板, 用于半导体洁净室厂房搭建, 采用岩棉作为芯材, 配合常规/特殊涂层钢板, 工厂预制加工, 现场拼接安装, 安装方便快捷。

深圳市纯水一号科技股份有限公司

14B95

### 工业超纯水系统



应用技术: 预处理、反渗透(RO)、电除盐(EDI)、离子交换等; 采用“全膜法”先进工艺。 应用领域: 半导体芯片清洗、光伏电池制造、液晶面板、光学光电等对水质要求极高的电子工业领域。

深圳超纯水科技股份有限公司

15E25

### 水处理系统案例



公司致力于为新能源光伏、半导体、电子显示等前沿科技行业提供超纯水处理及循环再生系统解决方案。公司主营业务包括超纯水制备、废水处理及循环利用、绿色清洁生产与资源化以及相关运营服务等, 旨在助力客户实现生产过程的可持续性升级及资源最大化利用。

广东百惠浦环保节能发展有限公司

15A07

### 污水处理设备



非标定制一体化污水处理设备、撬装式纯水、中水设备, 所有设备高度集成, 全自动智能运行, 占地小、能耗低、维护保养简单。适配工厂各类污水治理、农村、小区、医院、学校等。

华思蓝半导体设备(张家港)有限公司

14B21

### 尾气处理设备



该设备可以用于处理砷烷磷烷MOCVD设备产生的废气, 通过化学溶液与废气充分结合发生氧化-还原化学反应, 达到安全有效的去除气体中的含砷/磷化合物的目的。



## 科研院所&高校

[领取参观证件](#)

清华大学（集成电路学院）

16E48

### 连续无感血压监测手环



本产品是一款面向日常血压监测与心血管健康管理的轻量化可穿戴产品。产品无需传统袖带反复充气加压，采用石墨烯半球形柔性压力传感器与PPG光学传感模块，同步采集腕部桡动脉机械脉搏波和光学容积脉搏波。系统通过分析脉搏波形态、心率及多模态信号特征，并结合个体化校准算法，实现收缩压、舒张压、心率及脉搏波状态的连续估计。

清华大学（集成电路学院）

16E48

### 双模态智能手套

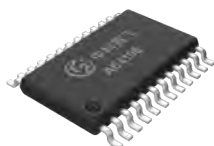


本产品是一款面向手部动作捕捉与关节角度监测的双模态智能感知手套，创新集成光纤光栅传感器与石墨烯柔性应变传感器，可同步获取手指弯曲、关节运动及动态姿态信息。光纤光栅具备抗电磁干扰、稳定性高等特点，石墨烯柔性传感器具有高灵敏度、轻薄贴合和快速响应优势，两类信号相互补充，可提升复杂动作识别与角度测量的可靠性。该手套可用于人机交互、康复训练、机器人遥操作、虚拟现实及精细动作分析等场景。

广东省大湾区集成电路与系统应用研究院

16E49

### 车规级多通道半桥驱动芯片AE4108

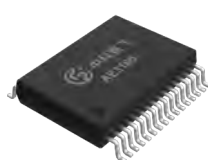


一款多通道半桥驱动器，每通道可配置为高边或低边驱动。可以通过SPI进行开/关控制，并具有完善的诊断和保护功能，例如负载开路诊断，短路、过温、过压、欠压保护等。在电源电压过低或过高时，每一个输出通道可单独关闭输出或者保持开启。

广东省大湾区集成电路与系统应用研究院

16E49

### 功能安全SiC/IGBT高压隔离栅极驱动AE3160



先进的功能安全高压隔离栅极驱动器，可通过多种机制稳健可靠地实现功率器件的开启和关断，具有用于高可靠性系统（ASIL D）设计的自检、控制和保护功能。

上海交大无锡光子芯片研究院

16E55

### 晶圆级薄膜铌酸锂光子芯片



CHIPX基于薄膜铌酸锂材料、DUV光刻工艺和干法刻蚀工艺的晶圆级光子芯片工艺技术，并结合光波导结构设计制备低损耗薄膜铌酸锂光波导，实现了更高的光束束缚能力、调制效率与集成密度。可实现大规模光子神经网络的高速调制及ns级的光开关切换速度，进而实现光量子计算。

上海交大无锡光子芯片研究院

16E55

### 大规模混合集成光量子计算机TuringQ Gen2



大规模混合集成光量子计算机TuringQ Gen2，依托室温可部署的光量子路线，突破传统量子设备低温部署限制，可直接嵌入现有 IDC、超算机房，在高维优化、分子仿真、量子增强大模型、高速光互联等场景具备指数级算力加速能力，已商用光量子计算系统TuringQ Gen2：单机可支持56个纠缠量子比特，支持上万变量优化求解。

广东中科半导体微纳制造技术研究院

16E47

### 微纳加工服务



目前平台能够提供从DUV光刻到高精度封装的全流程解决方案，同时具备晶圆代工、工艺研发、人才培养、设备维保、厂务服务等，可24小时快速响应。此外，平台已成功搭建硅基MEMS、氮化镓半导体、生物医疗芯片、光电器件四条功能完善的加工工艺线，可为粤港澳大湾区乃至全国各地的智能终端、电力电子、医疗健康等行业客户提供全栈式解决方案。

广东中科半导体微纳制造技术研究院

16E47

### 材料外延生长服务



专注于第三代半导体材料外延生长技术，围绕5G移动通信与电力电子、新型显示与汽车光电子、日盲紫外探测与紫外消杀光源等应用领域对外提供公共服务。该区域拥有近2000平方米的千级超净净化间、10余套多型号材料外延生长的MOCVD设备和20余套满足配套材料/器件检测的测试设备。



科研院所&高校

领取参观证件

广州市香港科大霍英东研究院

16E51

芯片封装与电子产品  
可靠性工程解决方案



围绕热机械应力、湿热耦合、互连疲劳、界面开裂、跌落冲击等关键问题，构建“失效分析-材料表征-仿真开发-测试验证-设计优化”全流程能力，助力客户定位失效根因、评估可靠性风险并优化产品设计。

广州市香港科大霍英东研究院

16E51

先进封装界面失效可靠性  
解决方案



通过量化评估EMC/基板、PI/RDL等多层界面失效风险，识别材料、结构与工艺关键影响因素，实现界面可靠性在设计阶段的预测、验证与优化，为先进封装结构设计、材料选型和工艺窗口优化提供技术支持。

深圳先进电子材料国际创新研究院

16E57

临时键合材料



芸卓新材开发一套全波段激光释放材料和临时键合粘接材料，通过二者将超薄器件和玻璃键合，在完成后续工艺后，通过激光作用于激光释放材料，光子能量转化为化学键断裂的能量，实现超薄器件与载体轻易分离。

深圳先进电子材料国际创新研究院

16E57

导热凝胶



芯泉半导体导热凝胶为单组份后固化产品，主要用于微电子器件和光电器件等提高热传导效率，填补器件中散热器与热源之间的空隙，从而确保器件的稳定运行和延长使用寿命；覆盖6.5、12、15、18W/m·K及以上导热系数产品，适配400G/800G/1.6T等光模块。产品包括金刚石体系及非金刚石体系，同等BLT下具有高导热、低热阻、低挥发渗油等差异化优势。

北京理工大学重庆微电子研究院

16E52

微型傅里叶光谱仪

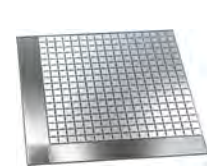


本产品是一款微型化傅里叶变换红外光谱仪，内置迈克尔逊干涉仪、控制电路与计算电路，全部集成于紧凑外壳中（169×105×65mm，重约450g），可通过以太网连接电脑直接操作。核心优势：光谱范围500~2600nm，分辨率优于5.78nm，信噪比6000:1，波长重复性优于0.5nm，具备实时校准功能，采样速度15fps，兼具宽谱段、高分辨、高信噪比、高波长精度等性能。

北京理工大学重庆微电子研究院

16E52

微镜阵列芯片



产品具备高填充率、驱动电压<10 V、大扫描角度及线性控制优势，功耗低、精度高。在光通信中，基于该芯片的光交叉连接（OCS）最大支持400×400端口容量；同时，芯片支持模拟控制，可对整体或单个微镜进行角度扫描与垂直位移独立调控，灵活适配无掩膜光刻、自适应光学、高光谱成像、动态目标探测、智能车灯等前沿应用。

深圳理工大学

16E58

问天类脑计算芯片和  
计算机



问天类脑计算系列产品包括单芯片、板卡、小机柜、计算机系统，打通了芯片架构-软件编译-算法模型-软硬件系统的全产业链条，并研发了完备的软件开发编译工具。该产品具有优异的可编程能力，可支持经典的神经元、网络模型，也可以支持用户自定的神经元、网络模型，拥有16个处理器的单芯片功耗仅为1.1瓦，并达到了人脑的实时响应能力，呈现良好的应用潜力。

深圳职业技术大学集成电路学院

16E56

GaN先进电源模组



GaN 先进电源模组面向AI数据中心电源、低空飞行器逆变、家庭储能双向变换、新能源汽车OBC/DC-DC、电动二轮车充电与驱动等场景。模组采用GaN功率芯片与高频拓扑、驱动保护及热管理协同设计，具备高效率、高功率密度、低温升、小体积和轻量化优势，可减轻散热压力，提升续航和系统集成度。



## 三展联动，一证通览 | 构建光电-半导体-电子嵌入式一体化

IICIE国际集成电路创新博览会（IC创新博览会）将与CIOE中国光博会、elexcon第23届深圳国际电子展暨嵌入式展同期同地举办，本届三展联动，规模达到32万平方米，预计汇聚超5000家参展企业、吸引逾24万名专业观众，共同打造集技术展示、行业交流与商业合作为一体的国际化高端平台，为光电、集成电路、电子与嵌入式系统等关键领域注入强劲创新动力；展会**围绕 AI 算力、消费电子 & AR/VR、智能汽车与具身机器人、半导体与智能制造**四大核心赛道，打通上下游技术、供应链与商业对接通道，加速跨产业融合创新，加速产业链融合与协同发展。

### ➤ 赋能 AI 算力基础设施，构建光存电芯一体化产业生态

AI 算力规模化落地是覆盖芯片、服务器、高速互联、海量存储、智算供电、数据中心集群的系统性工程，行业核心发展要素可概括为光、存、电、芯四大板块，三展精准分工、互补联动，完整覆盖算力全链路需求：

- **光：算力集群高速互联底座**

解决大模型训练、推理场景下服务器间超高速数据传输需求，是算力网络互通核心载体；

- **存：海量 AI 数据承载核心**

支撑大模型海量数据集存储、高吞吐读写需求，破解算力场景存储带宽瓶颈；

- **电：智算中心稳定节能保障**

面向大规模算力集群提供高效电源、功率器件、散热配套，降低算力运营能耗；

- **芯：AI 算力性能底层上限**

GPU/ASIC/SoC、先进封装、半导体工艺材料决定算力硬件基础能力。

**IICIE国际集成电路创新博览会——半导体全产业链专业展示平台**，IICIE 承担着全链条底层工艺支撑的重要作用。展会不仅展示AI核心芯片，还将集中呈现半导体关键材料、晶圆制造设备、封测设备、2.5D/3D 先进封装、混合键合异构集成等核心技术与产品，AI算力下看先进封装如何突破芯片“内存墙”。

部分展示企业如：

- ✓ **晶圆制造及封装服务**：晶合集成、武汉新芯、积塔半导体、华天科技、芯植微、佰维存储、时代民芯、锐立平芯、新核芯、安吉海万欣…等；
- ✓ **半导体设备**：盛美上海、拓荆科技、华海清科、微崇半导体、华煜半导体、精测电子、北京中电科、中科飞测、隆友德、华卓精科、迈为技术、东方晶源、维嘉科技、三丰精密、容道社、冠礼科技、光粒半导体、理纯洁净、海目芯微、津上智造、钧华半导体、致和半导体、微法尔、四元数、海煜半导体、艾恩、博涛智能、芯慧联芯、佳智彩、运泰利、伊创、幂帆科技、昌鼎电子、稳顶聚芯、华封科技、西斯特；
- ✓ **半导体材料**：沪硅产业、天科合达、安集科技、中船特气、上海新阳、清溢微、西陇科学、方大炭炭、木林升、奔朗新材、亦盛科技、中宝新材、贵研半导体、华熔科技、道川半导体材料、云升新材、昆吾、洽美斯、宇腾、晨日科技、玻芯成、创格、基迈克、爱科迈、沃尔德、抚顺特钢、中色东方集团、YINCAE英凯等；

领取参观证件

35



**CIOE中国光博会——信息通信展**聚焦高速数据传输的核心环节，集中展示高速光模块、LPO/NPO/CPO方案、高性能光芯片、OCS 全光交换、算力组网核心高速连接器、光测试测量设备、光无源器件等，完整覆盖智算互连全链路。

部分展示企业如：

- ✓ **光芯片**：COHERENT高意、MITSUBISHI ELECTRIC、SICOYA、SIFOTONICS、WD PHOTONICS、芯思杰、奇芯、铌奥光电、长光华芯、赛勒、羲禾、国科光芯、仕佳、鼎芯、剑桥、云岭、曦智科技；
- ✓ **光模块**：海思、光迅、华工正源、新易盛、纳真科技、剑桥、立讯技术、联特、智禾光通、德科立、昂纳、长芯博创、迅特、COHERENT高意、SOURCE PHOTONICS、钧恒；
- ✓ **光纤光缆**：CORNING、长飞、亨通、中天、特发、烽火、永鼎、LIGHTERA、华信藤仓、中住光纤、通光、飞瓴、远东，日海、仕佳、雅信通；
- ✓ **交换机与服务器**：新华三、锐捷、烽火、光库、博达、三石园、光隆科技、星融元、创新胜为、亨璞半导体、希力通讯等；

**alexcon深圳国际电子展暨嵌入式展——**补齐 AI 算力集群终端配套硬件，聚焦高速存储模组、大功率电源管理、功率半导体、嵌入式边缘 AI 主板、高速互连元器件等，适配超大规模智算机房高吞吐、高密度供电需求，提供整机、板卡、嵌入式系统级完整硬件方案。

部分展示企业如：

- ✓ **存储芯片**：长江存储、长江万润、朗科、东芯、宇瞻、科摩思、德明利、喻芯、博雅、华讯、迈德迦、金胜、舜铭、华芯星、威刚等；
- ✓ **嵌入式**：研华、SEGGER、安勤、璞致电子、芯驿电子、正点原子、韬睿、晟天维、Linaro等；
- ✓ **功率器件及电源**：上海贝岭、爱浦、荣和美、芯龙、台懋、信安半导体、江智科技、源博科技等；
- ✓ **连接器**：硕凌、宇熙、福顺、创豪欣、精途、伟达鑫、万达、五盈等；

\*以上企业排名不分先后

三展联动相关会议：

\*会议名称以现场为准

| 时间            | 会议名称                          | 会议地点           | 展馆号   |
|---------------|-------------------------------|----------------|-------|
| 09/09下午       | AI时代高速光传输技术创新论坛               | 9号馆二楼9A        | 9号馆   |
| 09/09下午       | 光电产业高峰论坛--光电“芯”未来             | 13号馆馆内会议室      | 13号馆  |
| 09/09下午       | 2026中国MicroLED CPO产业链创新发展高峰论坛 | 14号馆二楼14B会议室   | 14号馆  |
| 09/09 -/09/10 | 第八届中国嵌入式技术大会                  | 16号馆会议室1       | 16号馆  |
| 09/09全天       | 固态变压器（SST）技术创新与产业发展论坛         | 18号馆一楼CC105A   | 18号馆  |
| 09/10 下午      | AI数据中心光电融合技术创新论坛：聚焦NPO        | 北登录大厅二楼媒体中心A   | 北登录大厅 |
| 09/09 -/09/10 | 第十届中国系统级封装大会—— AI算力与CPO       | 北登录大厅二楼媒体中心B&C | 北登录大厅 |
| 09/10 全天      | AI算力集群光互连技术发展论坛               | 9号馆二楼9B        | 9号馆   |
| 09/10 全天      | 光电融合技术与产业发展论坛                 | 9号馆二楼9C        | 9号馆   |
| 09/10 上午      | AI浪潮下的光电技术：行业深度洞察             | 13号馆馆内会议室      | 13号馆  |
| 09/10 下午      | ePIXfab中欧硅基光电子论坛              | 13号馆馆内会议室      | 13号馆  |
| 09/10 全天      | AI算力时代硅光产业峰会                  | 14号馆内会议室-高峰论坛区 | 14号馆  |
| 09/10全天       | 先进封装与测试技术论坛                   | 14号馆二楼14C会议室   | 14号馆  |

[领取参观证件](#)



## ➤ 赋能半导体制造与智能制造产业升级

三展联动整合智能制造全产业链资源，一站式集中展示半导体材料、半导体设备、半导体制造及封装服务、光学精密加工、激光器及激光设备、工业嵌入式、核心零部件系统、测试测量等，完整覆盖半导体制造与智能制造在芯片制造与封装检测、光学精密加工、视觉检测、激光制造等全技术链路，赋能半导体与智能制造提质增效、柔性智造升级：

- **半导体材料**：支撑晶圆制程、芯片互连与封装成型，夯实芯片制造物质基础；
- **半导体设备**：晶圆制造/封测装备，筑牢智造终端核心芯片供给底座；
- **晶圆制造与封测服务**：覆盖晶圆制程与高端封装工艺，赋能芯片制程迭代与规模化量产落地；
- **测试测量**：全维度检测校准，管控设备精度与量产工艺品质；
- **工业视觉**：高精度视觉识别，破解产线质检、定位、测量核心难题；
- **光学精密制造**：微纳级高精加工，满足精密构件异形制造需求；
- **激光器及激光加工制造**：高能激光制程，实现切割、焊接、打标及表面处理；
- **工业嵌入式**：高可靠端侧算力，支撑产线运算与设备联动调控；
- **核心零部件系统**：高端功能组件，保障智能装备长效稳定运行。

**IICIE国际集成电路创新展**——展会现场将集中展示精密机械与结构件、流量/压力控制、射频/电源模组、运动控制、机器视觉、传感器等核心零部件，半导体设备龙头企业齐聚，助力自动化设备切入高端赛道；通过现场半导体高端装备、精密产线实景观摩与技术对接，帮助自动化设备厂商直观了解半导体领域严苛标准与升级方向，快速补齐技术、工艺与场景应用短板，高效切入半导体高端装备市场。

### 部分展示企业如：

- ✓ **半导体材料**：沪硅产业、天科合达、安集科技、中船特气、上海新阳、清溢微、西陇科学、方大炭炭、木林升、奔朗新材、亦盛科技、中宝新材、贵研半导体、华熔科技、道川半导体材料、云升新材、昆吾、洽美斯、宇腾、晨日科技、玻芯成、创格、基迈克、爱科迈、沃尔德、抚顺特钢、中色东方集团、YINCAE英凯等；
- ✓ **半导体设备**：盛美上海、拓荆科技、华海清科、微崇半导体、华煜半导体、精测电子、北京中电科、中科飞测、隆友德、华卓精科、迈为技术、东方晶源、维嘉科技、三丰精密、容道社、冠礼科技、光粒半导体、理纯洁净、海目芯微、津上智造、钧华半导体、致和半导体、维嘉科技、微法尔、四元数、海浥半导体、艾恩、博涛智能、芯慧联芯、佳智彩、运泰利、伊创、幂帆科技、昌鼎电子、稳顶聚芯、华封科技、西斯特等；
- ✓ **晶圆制造与封测服务**：晶合集成、武汉新芯、积塔半导体、华天科技、芯植微、佰维存储、时代民芯、锐立平芯、新核芯、安吉海万欣等；
- ✓ **半导体核心零部件及智能制造方案**：中科仪、新松半导体、万瑞冷电、上银科技、新莱集团、灿锐科技、司倍克、基恩士、冠业传动、欧莱新材等。

**CIOE中国光博会**——展示高精度工业镜头、工业传感器、2D/3D 机器视觉相机、激光器、激光打标 / 切割 / 焊接设备、光谱检测仪器、红外测量设备、光学镀膜设备、光学系统等，用于精密制造缺陷检测、尺寸测量、自动化定位。

领取参观证件

37



## 部分展示企业如：

- ✓ **晶圆制造与封测设备：**GlobalFoundries、Tower Semiconductor、芯联集成、联合微电子、PIC、ASTRO PLASMA、ASMPT、JEOL、Raith、E-Globleedge、Samco、纳微科毅、润华全芯微、施密科、思立康、华创智能、Finetech、MRSI(Mycronic Group)、MKS、OXFORD INSTRUMENTS、智立方、深圳科瑞、铭赛机器人、凯格精密、快克芯装备、轻蜓、思波微、诚锋电子、中科光智、MPI、和林微纳、森美协尔、PI、东方马达、ACS运动控制（中国）
- ✓ **激光器及激光加工：**IPG、锐科、大族、长光华芯、创鑫、Light Conversion、Litlil、富通尼、罗悉激光、华光、中辉、晶众、公大激光、英诺激光、卓立汉光、英谷激光、华工、联赢、海目星、韵腾、镭射沃、玉之泉、艾贝特、紫宸、古洛、创科达、新耐视、正运动、奇光、菲镭泰克、迹点激光、环立；
- ✓ **智能装备及工业自动化：**华工、芯碁微、米思米、东佑达、圭华智能、矽万、库尔特埃莎、固安力、精准机械、晨兴智能、凯特精密、誉展精密、立可自动化、魔技纳米、菲格斯、佳迈、锐健、艾瑞森、武藏、进和、藕道智能、繁易、凯福、金源、千里智能、爱合发、研成工业、多场科技、卓创、捷传、万合精密、永翔顺；
- ✓ **精密光学加工：**阿美特克·普瑞思泰克、DKSH、Satisloh、克兰菲尔德精密、广浩捷、优普纳、北京海普超精、博众泰达、华粹、神工科技、天仁微纳、芝浦机械、施耐德电气、大昌洋行、善能精密、大敏尚东、朗信光学、锡斌光电、恒泰光学、通用集团机床院；
- ✓ **光学镀膜设备：**布勒莱宝、日本光驰、博顿光电、汇成真空、上海哈呐、艾微普、IZOVAC、国泰真空、新柯隆、佑伦真空、杰莱特、中兴光电、昭和真空、哈呐、其芒、派莱特、友臻、天一国泰、梭莱、捷佳创、纳峰、兴南真科、镭茂科技、中科九微、朗为、弘浦；
- ✓ **红外测试测量：**索雷博、Optris、欧普特科技、振兴计量、HGH、东部科技、宇桥优信、迈创分析仪器、盈盛源、英达高、布莫让、HGH、中电科四十一所、必达泰克、德美机电、极源光电、天枢智测；
- ✓ **工业传感器：**米铎、Stella、ODTech、滨松、锐芯微、派徕兹、光引科技、万赢、睿芯源、西曼传感、豪末、远讯光电、映讯芯光、芯晟捷创、杭高睿光、恩弼科技、乐成光电、智恒、可天士电子、阿米精控、传周半导体。

**alexcon深圳国际电子展暨嵌入式展——打造智能制造硬件底座：**工业嵌入式主板、PLC 核心控制单元、伺服驱动电源、工业级元器件、高可靠连接器、宽温存储、工业物联网网关，提供标准化产线控制、边缘计算整机解决方案，适配 3C、半导体、新能源全行业自动化产线。

**部分展示企业如：**如研华、安勤、SEGGER、星翼电子、韬睿、立功电子、哲戈微、芯驿电子、璞致电子、晟天维、京泉华等。

*\*以上企业排名不分先后*

## 特色展示区及馆号：

- ✓ 激光焊接展示区——2号馆
- ✓ 蓝宝石加工应用展区——3号馆
- ✓ 光学注塑/模压非球面展区——3号馆

领取参观证件

38



三展联动相关会议：

\*会议名称以现场为准

| 时间           | 会议名称                                               | 会议地点                             | 展馆号     |
|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| 09/09 下午     | 激光微纳加工先进制造论坛                                       | 2号馆二楼2C                          | 2号馆     |
| 09/09 下午     | 激光技术赋能半导体制造论坛                                      | 2号馆二楼2A                          | 2号馆     |
| 09/09 下午     | 激光焊接助力智能制造创新应用论坛                                   | 4号馆馆内会议室                         | 4号馆     |
| 09/09 下午     | 光学半导体检测技术论坛                                        | 5号馆二楼5B                          | 5号馆     |
| 09/09 下午     | 纳米压印制造技术论坛                                         | 5号馆二楼5C                          | 5号馆     |
| 09/09 下午     | 先进材料创新发展大会 — 突破互连与散热极限-AI 异质整合封装之关键材料              | 13号馆二楼13C会议室                     | 13号馆    |
| 09/09下午      | 半导体制造核心设备与零部件发展论坛                                  | 16号馆馆内会议室                        | 16号馆    |
| 09/09 -09/11 | 第八届中国嵌入式技术大会                                       | 16号馆会议室1                         | 16号馆    |
| 09/10 全天     | IWAPS 国际先进光刻技术研讨会                                  | 南登录大厅二楼红树林厅A                     | 南登录大厅   |
| 09/10 上午     | 超构&微纳光学制造技术论坛                                      | 5号馆二楼5A                          | 5号馆     |
| 09/10下午      | 2026智能制造创新发展大会                                     | 14号馆二楼14A会议室                     | 14号馆    |
| 09/10 下午     | 光学超精密加工制造论坛                                        | 5号馆二楼5A                          | 5号馆     |
| 09/10 全天     | 光学真空镀膜大会                                           | 7号馆馆内会议室                         | 7号馆     |
| 09/10全天      | 先进封装与测试技术论坛-从 CoWoS 到 CoPoS:共探 AI 时代先进封装技术演进与供应链布局 | 14号馆二楼14C会议室                     | 14号馆    |
| 09/10全天      | 智能工控赋能自动化创新论坛                                      | 15号馆馆内会议室                        | 15号馆    |
| 09/10全天      | 宽禁带半导体先进封装SiC嵌入PCB装备及材料供应链解决方案                     | 16号馆馆内会议室                        | 16号馆    |
| 09/11全天      | IWAPS 国际先进光刻技术研讨会                                  | 5号馆二楼5AB<br>6号馆二楼6AB<br>9号馆二楼9AB | 5/6/9号馆 |
| 09/11上午      | 先进光学与智能传感技术论坛                                      | 1号馆二楼1C                          | 1号馆     |
| 09/11上午      | 第二届边缘AI与智能控制技术行业论坛                                 | 15号馆馆内会议室                        | 15号馆    |
| 09/11上午      | 半导体洁净厂务与能源管理论坛                                     | 16号馆馆内会议室                        | 16号馆    |

[领取参观证件](#)



## ➤ 全链条赋能消费电子、AR&VR创新及发展

三展联动整合消费电子、AR&VR全产业链资源，一站式集中展示**光学成像及感知、新型显示、AI嵌入式、精密连接器、芯片与存储、AR/VR终端及器件、测试测量**等，七大技术板块完整覆盖消费电子及AR/VR空间感知、视觉交互、端侧智能、高速互联、算力存储、性能检测全技术链路，全链条赋能消费电子、AR&VR创新及发展。

- **光学成像/感知**：高精度二维成像与三维感知，破解终端影像采集、空间交互识别难题；
- **新型显示**：打造低功耗高清柔性沉浸式视觉交互界面；
- **AI嵌入式**：端侧轻量化算力，实现设备实时智能运算与自适应调控；
- **精密连接器**：高频高速微型连接，适配轻薄化终端电子电气架构；
- **芯片与存储**：高算力核心与高速存储，支撑终端高负载运行与数据读写；
- **AR/VR终端及器件**：轻量化近眼模组，构建沉浸式虚实融合交互场景；
- **测试测量**：全维度性能检测，保障产品标定与量产可靠性管控。

**IICIE国际集成电路创新博览会——**汇聚消费级芯片及芯片设计厂商，集中展示 AI 算力芯片、主控 SoC、蓝牙 BLE 射频芯片、电源管理 PMIC、专用场景 AI 芯片等核心集成电路产品；

部分展示企业如：中兴微电子、华润微电子、比亚迪半导体、爱特微、北京君正、兆芯集成、澜起科技、紫光国微、广立微、复旦微电子、灿芯半导体、谱瑞集成、极海半导体、成都华微电子、国芯科技、算能科技、京微齐力、鸿芯微纳、珠海芯动力、进迭时空、隼瞻科技、合肥乾芯、二进制半导体、乘翎微电子、达摩院、美创希、清芯智研、中德工业、华沅微、思凯迈、珈港科技、妙存科技、一微科技、智现未来、泰芯半导体、象帝先、智芯科、澜昆微、Advinno等。

**CIOE中国光博会——**集中展示光学材料及元件、光学镜头及模组、3D视觉、激光雷达、光谱传感、Micro LED、硅基OLED、微显示、光波导、AR&VR一体机等。

部分展示企业如：

- ✓ **光学材料及元件**：HOYA、OHARA、肖特、新华光、戈碧迦、蓝特光学、爱特蒙特光学、水晶光电、联合光科、伯恩光学、永新光学、纳宏光电、激埃特光电；
- ✓ **光学镜头及模组**：舜宇光学、凤凰光学、宇瞳光学、AAC Optics、联合光电、特莱斯光电、弘景光电、歌尔光学、福光股份、永新光学、中光学集团、成都光明、光电集团、蓝特光学、联合光科、立讯精密；
- ✓ **3D视觉**：艾迈斯欧司朗、芯视界、睿熙科技、瑞识科技、志强视觉、见行科技、美芯晟科技；
- ✓ **光谱传感**：智感光锥、彩谱科技、高谱科技、光芯智谱、优尼科、多谱光学、吉林求是、spectricon、巨哥科技、辰昶仪器、中达瑞和、西湖智能视觉、光引科技、光寻智能、Spectricity NV、鹿起科技、高光特光电；
- ✓ **Micro LED & OLED**：水晶光电、微玖、宏禧科技、思坦科技、昀光科技、睿显科技、镭昱光电、诺视科技、视涯、国兆光电、芯视佳、芯屏半导体、晶湛半导体、斯多福；
- ✓ **光波导及AR&VR**：中科融合、立讯精密、歌尔光学、首镜科技、理湃光晶、AAC Optics、谷东科技、小象光显、鲲游光电、诠视科技、InsEye、Raontech、鸿石、MyRias、Illusion、万有引力、康耐特、海联晶盛、微宇视界、Brilliance、泰美克、慕德微纳、拓比Tobii；

领取参观证件

40



- ✓ **光学测试测量：**基恩士、卡尔蔡司、泰勒·霍普森、翟柯 ZYGO、布鲁克、松下、全欧光学、三丰、海克斯康、中图仪器、优可测、复享光学、东正光学、宇川光学、马波斯、中图科技、英特飞、兆丰、星庆、图谱、昂科、知常、拓界、麦克奥迪、书敏、华中精密、科峰、光衡、台湾超微；

**elexcon深圳国际电子展暨嵌入式展——**深耕电子硬件与嵌入式系统赛道，覆盖全品类电子元器件、存储芯片及模组、功率半导体、电源解决方案、边缘嵌入式 AI、连接器等硬件基础组件，补齐终端产品底层硬件供应链。

部分展示企业如：

- ✓ **芯片及模组：**航顺、立功科技、灵动微、码灵、速显微、凌烟阁、本原微、唯创知音、九芯等；
- ✓ **嵌入式：**研华、SEGGER、安勤、璞致电子、芯驿电子、正点原子、韬睿、晟天维、Linaro等；
- ✓ **电子元器件：**京泉华、厚声、微容、宇阳、深圳华强、扬兴科技、信维电子、德鸿感应、进工、新天源、芯声微、富捷电子、奥宇达、华晟电通、益嘉源、厚为电子、军康电子、灿昇等；
- ✓ **电源：**京泉华、上海贝岭、爱浦、荣和美、芯龙、台懋、信安半导体、江智科技、源博科技等；
- ✓ **连接器：**硕凌、宇熙、福顺、创豪欣、精途、韩达鑫、万达、五盈等；

三展联动相关会议：

\*会议名称以现场为准

| 时间           | 会议名称                   | 会议地点         | 展馆号  |
|--------------|------------------------|--------------|------|
| 09/09 下午     | 全球空间计算产业发展论坛           | 2号馆馆内会议室     | 2号馆  |
| 09/09 下午     | AR/VR 光学技术应用高峰论坛       | 2号馆二楼2B      | 2号馆  |
| 09/09 下午     | 智能家居发展趋势高峰论坛           | 6号馆二楼6A      | 6号馆  |
| 09/09下午      | RISC-V产业生态创新大会         | 14号馆二楼14C会议室 | 14号馆 |
| 09/09下午      | 第三届AI赋能消费电子创新论坛        | 14号馆馆内会议室    | 14号馆 |
| 09/09 -09/11 | 第八届中国嵌入式技术大会           | 16号馆会议室1     | 16号馆 |
| 09/10上午      | 端侧AI芯势力:2026智能终端芯片生态峰会 | 14号馆馆内会议室    | 14号馆 |
| 09/10 全天     | 全球微显示产业发展论坛            | 2号馆馆内会议室     | 2号馆  |
| 09/10 全天     | AI AR眼镜产业发展论坛          | 2号馆二楼2C      | 2号馆  |
| 09/10 下午     | 手持智能影像设备技术发展论坛         | 3号馆馆内会议室     | 3号馆  |
| 09/10下午      | 智算之源:2026芯算力创新峰会       | 14号馆馆内会议室    | 14号馆 |
| 09/11 上午     | 大空间交互与沉浸体验技术高峰论坛       | 2号馆馆内会议室     | 2号馆  |
| 09/11 上午     | 光电赋能低空经济新质生产力论坛        | 7号馆馆内会议室     | 7号馆  |

- 特色展示区及馆号：**
- ✓ XR 眼镜拆解专区——2号馆；
  - ✓ 望远镜及天文器材展区 ——3号馆；
  - ✓ RISC-V 生态+应用展示区——14号馆；
  - ✓ AI + 应用特色展区——14号馆；





## ➤ 赋能智能汽车与具身机器人产业

### 智能汽车赛道

三展联动整合智能汽车全产业链资源，一站式集中展示车载光通信、多传感器融合解决方案、车载显示、汽车三电系统、整车连接线束等，五大技术板块完整覆盖智能汽车感知、高速传输、动力供给、整车布线、座舱交互全技术链路：

- **车载光通信**：带来百 Gbps 无损传输，解决高阶智驾大数据传输难题；
- **多传感器融合**：全天候精准环境感知，消除单一传感器识别盲区；
- **车载显示**：打造沉浸式人车交互座舱；
- **三电系统**：稳定支撑新能源车续航、快充与全车智能硬件供电；
- **轻量化高屏蔽线束**：适配新一代中央集中式电子电气架构；

**IICIE国际集成电路创新博览会——**汇聚芯片及芯片设计厂商，涵盖MCU、SoC、运动控制芯片、安全加密芯片，配套车规晶圆制造、高可靠封装；还将设置AI+特色展示区，汇聚芯片、方案等企业；

部分展示企业如：中兴微电子、华润微电子、比亚迪半导体、爱特微、北京君正、兆芯集成、澜起科技、紫光国微、广立微、复旦微电子、灿芯半导体、谱瑞集成、极海半导体、成都华微电子、国芯科技、算能科技、京微齐力、鸿芯微纳、珠海芯动力、进迭时空、隼瞻科技、合肥乾芯、二进制半导体、乘翎微电子、达摩院、美创希、清芯智研、中德工业、华沅微、思凯迈、珈港科技、妙存科技、一微科技、智现未来、泰芯半导体、象帝先、智芯科、澜昆微、Advinno等。

**CIOE中国光博会——车载方面**：覆盖汽车光通信、汽车感知、车载显示等三大板块，集中展示光芯片、模块、车规光纤线束、车载摄像头、车载红外夜视、3D视觉感知、激光雷达、智能座舱显示、Mini/Micro LED等；

部分展示企业如：

- ✓ **车载摄像头**：舜宇光学、联合光电、宇瞳光学、凤凰光学、AAC Optics、特莱斯、福特科光电、中光学、海创光电；
- ✓ **3D视觉**：艾迈斯欧司朗、芯视界、睿熙科技、瑞识科技、志强视觉、美芯晟科技、芯探科技、思岚科技、向至科技、力策科技、国微感知、蓝海光电、启激科技；
- ✓ **红外夜视**：高德红外、睿创微纳、大立科技、富吉瑞、夜视院集团、海康微影、华感科技、中星时代、焜腾红外、华国光学、深知未来、光智科技；
- ✓ **车载显示**：水晶光电、赛富乐斯、芯视元、思坦科技、立琰半导体、镭昱光电、视涯、昀光科技、西湖燕山科技、芯视佳、宏禧科技、诺视科技；
- ✓ **芯片及模块**：COHERENT高意、鹏瞰半导体、光莆、光迅、芯思杰、度亘、大普技术、三菱、三安光电、长光华芯、奇芯、光特、中电十三所、赛勒、国科光芯、三优、帝奥微、优迅股份、米硅、芯升半导体、苏纳、广州光为、亿芯源、申和、鸿星科技、彼格、圣达、杭州先导；
- ✓ **车载网络**：长飞、烽火、科谱、华工正源、CORNING、欧亿光电、乐庭智联、永鼎、华晟福涛。

领取参观证件

42



**elexcon深圳国际电子展暨嵌入式展——**覆盖车规与机器人硬件配套：车规被动元器件、车载电源管理、伺服驱动功率器件、机器人嵌入式运动控制主板、工业级高速连接器、宽温存储模组、边缘实时控制系统，提供整车电控、机器人整机集成硬件方案。

**部分展示企业如：**研华、长江存储、SEGGER、航顺、灵动微、上海贝岭、朗科、东芯、德明利、宇瞻、信维电子、微容、京泉华、宇阳、厚声、立功科技、安勤、九芯等；

三展联动相关会议：

\*会议名称以现场为准

| 时间            | 会议名称                       | 会议地点         | 展馆号  |
|---------------|----------------------------|--------------|------|
| 09/09 下午      | 2026第五届车载摄像头前沿技术与测试方法研讨会   | 1号馆二楼1B      | 1号馆  |
| 09/09下午       | RISC-V产业生态创新大会             | 14号馆二楼14C会议室 | 14号馆 |
| 09/09 -/09/10 | 第八届中国嵌入式技术大会               | 16号馆会议室1     | 16号馆 |
| 09/10 全天      | 新能源汽车电子创新技术论坛              | 14号馆二楼14A    | 14号馆 |
| 09/10 全天      | 第八届“光”+智能汽车技术高峰论坛          | 5号馆二楼5C      | 5号馆  |
| 09/10 全天      | 第41届“微言大义”研讨会:3D传感与成像技术及应用 | 6号馆二楼6B      | 6号馆  |
| 09/10 全天      | 2026车载光通信技术创新应用论坛          | 9号馆二楼9A      | 9号馆  |
| 09/10 下午      | 汽车芯片产业创新论坛                 | 14号馆二楼14B会议室 | 14号馆 |

- 特色展示区及馆号：
- ✓ 车载显示展示区——2号馆；
  - ✓ AI+应用展区（汽车电子）——14号馆；
  - ✓ 车载光通信实景体验区——13号馆；

具身机器人赛道

三展同步联动呈现全套核心软硬件方案：依托视觉感知模块完成目标识别、人机交互与近距离环境探测；功率器件负责电能变换与伺服电机控制，直接决定机器人运动性能、续航能力与机身轻量化水平；连接器及线束同步承载动力供电与高速数据双通道传输；全栈芯片构建机器人“决策大脑、运动小脑、感知神经”完整算力架构。

- 特色展示区：
- ✓ 特设“具身机器人展示区”，位于CIOE中国光博会6号馆，部分参与企业如智身科技、遨博智能、瑞松机器人、蓝海光电、格科微、华域汽车等；

三展联动相关会议：

\*会议名称以现场为准

| 时间            | 会议名称                           | 会议地点      | 展馆号  |
|---------------|--------------------------------|-----------|------|
| 09/09下午       | 2026具身智能产业大会 --从算力到执行，构建具身智能系统 | 15号馆馆内会议室 | 15号馆 |
| 09/09 -/09/10 | 第八届中国嵌入式技术大会                   | 16号馆会议室1  | 16号馆 |
| 09/10 上午      | 面向具身智能的智能光学技术论坛                | 1号馆二楼1A   | 1号馆  |
| 09/10 全天      | 视觉感知·智造未来 - 具身智能机器人融合应用论坛      | 6号馆二楼6A   | 6号馆  |





## 组团参观

- 5人报名即可成团
- 专享便捷登记通道
- 团长及每位团员参观礼品
- 定制化观展资料，提高观展效率
- 展前快递入场证件、午餐券、免费深圳地铁票（电子）
- 专人专线接待，现场拍照留念
- 免费大巴接送（报名达35人，限3小时车程内）

[>>了解更多组团详情](#)[>>申请团体报名](#)

## 5人成团参观

[即刻组团申请](#)

截止时间：即日起至8月20日

提前获取入场证件  
及深圳电子地铁票午餐券  
(10人以上)免费接送巴士  
(35人以上)提前获取  
参观攻略VIP商贸配对  
及专人服务

## 一对一采购对接服务

IICIE 聚焦拥有采购决策权或建议权的企业高层及行业专业人士，倾力打造专业、高效的一站式商贸对接平台，旨在提升采购商与参展企业的现场沟通效率，促进商贸合作，推动半导体产业资源整合，助力双方实现精准、高效的一对一采购对接。

诚邀拥有采购决策权 / 建议权的企业高层、专业采购负责人加入 IICIE 2026 特邀买家阵营，独享定制化商贸配对服务！

[>>申请为VIP特邀买家](#)[领取参观证件](#)

44



## 交通指引：快速抵达深圳国际会展中心——北登录大厅（国展北地铁站）

➤ **地铁：**搭乘11号线（碧头方向）至**机场北站**换乘**20号线**（会展城方向）或至**南山站**换乘**12号线**（海上田园方向），**到达国展北站C1、C2口抵达会展中心-北登录大厅。**

➤ **自驾：**导航深圳市宝安区福海街道展城路1号，深圳国际会展中心**地下停车场：P2、P3、P4、P5。**

### ➤ 高铁抵达：

①**深圳北站：**乘坐地铁 5 号线（赤湾方向）至前海湾站，换乘地铁 11 号线（碧头方向）至机场站，再换乘地铁 20 号线（会展城方向）至国展北站C1、C2出口到达北登录大厅；

②**深圳东站：**乘坐地铁 14 号线（沙田方向）至布吉站，换乘地铁 11 号线（碧头方向）至机场站，再换乘地铁 20 号线（会展城方向）至国展北站C1、C2口到达北登录大厅；

③**福田站：**乘坐地铁 11 号线（碧头方向）至机场站，换乘地铁 20 号线（会展城方向）至国展北站C1、C2口到达北登录大厅。

### ➤ 深圳宝安国际机场抵达：

抵达机场后，可选择出租车，或直接乘坐地铁 11 号线（碧头方向）至机场站，换乘地铁 20 号线（会展城方向）至国展北站C1、C2口到达北登录大厅。

➤ **广州白云国际机场抵达：**可乘坐高铁、巴士抵达深圳市内，换成公共交通至展馆。

### ➤ 香港出发：

#### ①香港中港城码头：

乘坐客船至深圳机场码头，再搭乘出租车到深圳国际会展中心(宝安)北登录大厅；

#### ②香港西九龙站：

可乘坐高铁至福田站，搭乘地铁11号线(碧头方向)到达机场北再换乘20号线，到达国展北站C1、C2口；

#### ③香港国际机场：

可搭乘跨境巴士、轮渡（海天客运码头至深圳蛇口码头）抵达，再换成深圳市内交通抵达展馆；

#### ④深圳各口岸：

福田、皇岗、罗湖及深圳湾等口岸，过关后再换成深圳市内交通抵达展馆。

详细交通信息请可进入官网查询：<https://www.iicieexpo.com/Traffic.html>

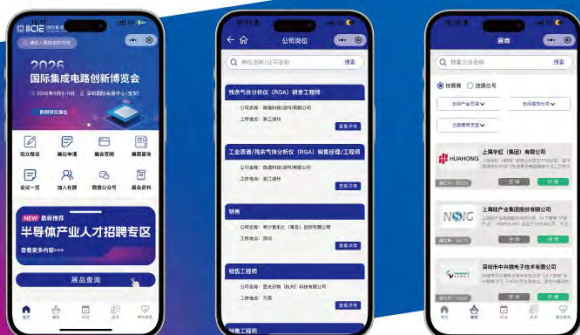
[领取参观证件](#)

45



## IICIE小程序、企业微信

# 找展商 查产品 搜会议 看直播



扫码并添加至“我的小程序”  
方便随时查看使用



扫码添加企业微信”  
进行行业交流群

## IICIE人才招聘专区

为助力企业精准、高效招揽集成电路领域顶尖人才，IICIE国际集成电路创新博览会特别推出线上“半导体产业人才招聘专区”，为企业与精英人才搭建起一座高效对接的桥梁，通过线上投递，优质简历直达半导体企业，精准锁定面试机会，直达现场面对面交流。



领取参观证件

# 第23届 深圳国际电子展 暨嵌入式展 elexcon 2026

All for AI, All for GREEN

为AI和双碳提供全栈技术与供应链支持

2026.9.9-11

深圳国际会展中心(宝安)

同期举办: CIOE  
中国光博会

IICIE  
国际集成电路创新博览会  
INTERNATIONAL INTEGRATED CIRCUIT INNOVATION FORUM

320,000m<sup>2</sup>

超级规模

240,000<sup>+</sup>

专业观众

5,000<sup>+</sup>

参展企业

三展联动 | 共建电子嵌入式 × 光芯融合新生态



即刻登记免费参观  
一证参观三展

芯片|存储|嵌入式|边缘AI  
功率器件与电源|无源器件  
SiP与先进封装|高速连接与连接器



# 第27届中国国际光电博览会

2026年9月9-11日  
深圳国际会展中心(宝安新馆)

260,000M<sup>2</sup> 展出面积  
150,000+ 专业观众  
4,000+ 参展企业

## 同期八大主题展



信息通信展  
INFORMATION AND COMMUNICATION EXPO



精密光学展&  
摄像头技术及应用展  
PRECISION OPTICS EXPO & CAMERA EXPO



激光技术  
及智能制造展  
LASER TECHNOLOGY & INTELLIGENT MANUFACTURING EXPO



红外技术及应用展  
INFRARED APPLICATIONS EXPO



智能传感展  
INTELLIGENT SENSING EXPO



光电子创新展  
PHOTONICS INNOVATION EXPO



AR&VR展  
AR&VR EXPO



新型显示技术展  
DISPLAY TECHNOLOGY EXPO

## 同期论坛



中国国际光电高峰论坛  
CHINA INTERNATIONAL  
OPTOELECTRONIC CONFERENCE

更多展会详情请登录

[WWW.CIOE.CN](http://WWW.CIOE.CN)



CIOE官方小程序



关注CIOE官方公众号

即刻扫码登记获取参观证件



登记成功后，人人可获得：  
半导体全产业链行业报告合集

涵盖芯片设计、晶圆制造、封测、设备、关键材料、核心零部件等热门领域  
(登记后15个工作日内发送至登记邮箱)